

股票简称：容大感光

股票代码：300576

# 深圳市容大感光科技股份有限公司

(Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.,Ltd.)

广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301(1-3 层)



## 2022 年度向特定对象发行股票

并在创业板上市

募集说明书

保荐机构（主承销商）



华泰联合证券有限责任公司

HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

二〇二三年一月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

1、本次向特定对象发行股票相关事项已经于2022年3月7日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，并于2022年7月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

2、本次发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本募集说明书所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

3、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。

本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和深交所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

4、本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过6,403.64万股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。

5、本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过67,000.00万元，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	光刻胶及其配套化学品新建项目	54,804.19	47,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		74,804.19	67,000.00

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

6、本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

7、本次向特定对象发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权不具备上市条件的情形发生。

8、本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

9、为完善和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司于2022年3月7日召开的公司第四届董事会第十三次会议及2022年7月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市容大感光科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》。

10、根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及《关于首发及再融资、重大资

产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司制定了本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明”。公司特别提醒投资者，公司制定的摊薄即期回报填补措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意投资风险。

## 重大风险提示

### 一、募集资金投资项目风险

#### (一) 募投项目新增产能消化风险

公司本次募集资金主要投向“光刻胶及其配套化学品新建项目”及“补充流动资金项目”。本次募投项目投产后，公司将具备 1.20 亿平方米感光干膜自有产能，较公司 2022 年 1-9 月感光干膜年化销量扩大约 37.85 倍；在报告期内公司的显示用及半导体用光刻胶产能利用率较低背景下，显示用及半导体用光刻胶将新增每年 1.53 万吨产能，产能扩大约 14.57 倍。对于感光干膜产品，根据福斯特及五江高科披露的已建产能及扩产计划，在公司本次募投项目投产后，国内感光干膜的产能规模预计约占 2025 年国内市场空间的比重为 73.78%；对于显示用及半导体用光刻胶，根据雅克科技、彤程新材、晶瑞电材、广信材料等主要企业披露的产能及扩产计划估算，在公司本次募投项目投产后，国内产能规模预计占 2025 年国内市场空间的比重为 40.01%。

如遇到市场开拓不及预期、宏观经济或下游 PCB、显示面板、半导体行业或消费电子、通讯、汽车、航空航天、军事装备等最终应用领域需求发生不利变化或若行业产能扩张超出预期甚至导致出现产能规模大于市场需求的情形、市场竞争加剧或管理不善等情形出现，将会导致本次募集资金投资项目新增产能存在无法按预期及时消化的风险。

公司在论证募投项目产能消化时，重点考虑并测算了公司现有主要客户及正在进行验证测试的新客户的需求情况。但一方面公司能否通过主要客户的验证测试存在不确定性；另一方面，主要客户均为相关行业内领先企业，其光刻胶产品供应商通常维持在两家或以上，客户根据产线需求分配订单，如果公司不能成为该等客户的首选供应商则可能无法取得充足订单，从而光刻胶项目存在产能消化风险。

#### (二) 募投项目效益不及预期的风险

本次发行相关的募投项目均围绕公司主营业务开展，光刻胶及其配套化学品新建项目税后内部收益率为 16.66%，项目预计效益水平是在综合考虑了公司

现有业务盈利水平、同行业类似项目或类似业务盈利水平、预计市场空间、市场竞争程度等因素基础上做出的审慎预测。

但募投项目的实施和效益产生均需一定时间，因此从项目实施、完工、达产以至最终的产品销售等均存在不确定性。若在募投项目实施过程中，宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化，产品技术路线发生重大更替，下游需求增长缓慢，公司产品验证进展不顺或市场开拓成效不佳，所处行业竞争加剧，公司产品销售价格持续下降以及其他不可预计的因素出现，都可能对公司募投项目的顺利实施、业务增长和预期效益造成不利影响。**特别的，若行业产能扩张超出预期甚至大于市场需求量，可能导致感光干膜行业竞争加剧，进而可能导致公司募投项目产能消化不及预期及市场价格下降至募投项目测算价格以下，募投项目存在效益不及预期的风险。若项目达产后的产品实际单位售价较预测价格下降超过 14.43%且单位产品成本不变时，项目会产生亏损；若项目达产后的产品实际单位成本较预测上涨超过 20.84%且单位售价不变时，项目会产生亏损。**

### **（三）募投项目涉及的技术实施及产品开发风险**

光刻胶及其配套化学品新建项目投产后，公司将新增**感光干膜自主生产能力和显示用光刻胶细分产品**。本次募投项目是公司顺应产业发展、响应客户需求、提升核心竞争力的重要战略布局。公司已对募投项目的可行性进行了充分地分析和论证，并且公司已在新产品、**新产线**的技术基础、生产工艺、**客户验证**和产能消化等方面做了充分准备，**相关产品已通过部分客户测试并已实现销售，预计技术实施风险较小**。如果项目无法顺利研发或投产，或因建成投产后市场环境发生较大不利变化、公司新产品的前期认证和市场开拓进展不畅等因素影响，**又或者产品通过客户验证后仍无法取得足量订单**，将对公司募投项目的实施及新产品的开拓产生一定的不利影响。

### **（四）新增折旧、摊销费用导致的利润下滑风险**

本次募投项目建成后，每年将会产生一定的固定资产、无形资产折旧摊销费用，其中建设期 2 年的折旧摊销费分别为 39.53 万元和 297.81 万元，占 2021 年净利润的 0.99%和 7.44%，投产期第一年的折旧摊销费为 3,312.58 万元，占

当年预计净利润的 **23.88%**。尽管公司对募投项目进行了充分论证和可行性分析，但上述募投项目收益受宏观经济、产业政策、市场环境、竞争情况、技术进步等多方面因素影响，若未来募投项目的效益实现情况不达预期，募投项目新增的折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响。

## 二、市场竞争加剧的风险

近年来，随着国内其他感光电子化学品企业的快速发展，以及具有技术、资金、渠道等多方面优势的行业内外资企业在我国生产基地的陆续建成，行业竞争日趋激烈。如果公司不能在技术、品牌、产品性能及成本等方面继续保持竞争优势，日益激烈的市场竞争会对公司的市场份额、盈利水平产生不利影响。

## 三、原材料价格波动的风险

报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比重分别约为 93.47%、88.75%、90.53%、**90.72%**，占比相对较高，原材料的价格变化将影响公司生产的稳定性和盈利能力。公司主要原材料为树脂、单体、助剂等，若未来宏观经济波动或市场供需不平衡等因素导致原材料价格大幅上升，或者主要原材料供应出现短缺等情形，公司未能及时有效应对，将会对经营业绩造成不利影响。



## 目 录

声 明.....	1
重大风险提示 .....	5
一、募集资金投资项目风险.....	5
二、市场竞争加剧的风险.....	7
三、原材料价格波动的风险.....	7
目 录.....	8
释 义.....	11
第一部分：常用词语.....	11
第二部分：专业术语.....	12
第一节 发行人基本情况 .....	14
一、发行人基本信息.....	14
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....	14
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况.....	16
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	26
五、发行人主要固定资产及经营资质状况.....	34
六、发行人生产水平及技术特点.....	38
七、现有业务发展安排及未来发展战略.....	38
八、财务性投资.....	40
九、报告期内存在未决诉讼、仲裁情况.....	43
十、报告期内存在行政处罚情况.....	44
第二节 本次证券发行概要 .....	46
一、本次发行的背景和目的.....	46
二、发行对象及与发行人的关系.....	50
三、本次向特定对象发行股票方案概要.....	51
四、募集资金投向.....	53
五、本次发行是否构成关联交易.....	54
六、本次发行不会导致公司控制权发生变化.....	54
七、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件.....	54

八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	54
<b>第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析</b>	<b>55</b>
一、本次募集资金投资项目概述	55
二、本次募集资金投资项目可行性分析	55
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	69
<b>第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</b>	<b>70</b>
一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况	70
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	71
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	71
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形	72
五、本次发行对公司负债情况的影响	72
<b>第五节 前次募集资金的使用情况</b>	<b>73</b>
一、前次募集资金的基本情况	73
二、前次募集资金实际使用情况	74
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明	76
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明	78
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况	80
六、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论	80
<b>第六节 与本次发行相关的风险因素</b>	<b>81</b>
一、募集资金投资项目风险	81
二、宏观经济波动风险	83
三、市场竞争加剧的风险	83
四、财务风险	83
五、经营风险	85
六、股价波动的风险	86
七、本次发行导致原股东分红减少、表决权被摊薄的风险	86

八、审批风险.....	86
九、发行风险.....	86
十、不可抗力和其他意外因素的风险.....	87
<b>第七节 与本次发行相关的声明 .....</b>	<b>88</b>
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.....	88
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	92
三、保荐人及其保荐代表人声明.....	93
四、发行人律师声明.....	95
五、会计师事务所声明.....	96
六、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项.....	99

## 释 义

在本尽职调查报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

### 第一部分：常用词语

发行人、容大感光、公司	指	深圳市容大感光科技股份有限公司
本次向特定对象发行股票、本次发行	指	发行人本次向特定对象发行股票的行为
容大化工	指	深圳市容大化工有限公司
容大有限	指	深圳市容大电子材料有限公司
控股股东、实际控制人	指	林海望、杨遇春、黄勇和刘启升
惠州科技	指	惠州市容大感光科技有限公司，公司的全资子公司
惠州容大	指	惠州市容大油墨有限公司，公司的全资子公司
苏州容大	指	苏州市容大感光科技有限公司，公司的全资子公司
珠海容大	指	珠海市容大感光科技有限公司，公司的全资子公司
高仕电研	指	广东高仕电研科技有限公司，公司的全资子公司
正奇新材	指	广东正奇新材料有限公司，公司的控股子公司
沃凯珑	指	宁夏沃凯珑新材有限公司，公司的参股公司
日本太阳油墨	指	太阳油墨制造株式会社
广信材料	指	江苏广信感光新材料股份有限公司
炎墨	指	中国台湾炎墨科技有限公司
日本旭化成	指	旭化成株式会社
日本日立化成	指	日立化成（HITACHI CHEMICAL）
JSR	指	JSR Corporation
东洋油墨	指	东洋油墨 SC 控股株式会社
住友化学	指	住友化学有限公司（SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,LIMITED）
三菱化学	指	三菱化学集团公司（Mitsubishi Chemical Group Corporation）
达兴材料	指	达兴材料股份有限公司
长兴材料	指	长兴材料工业股份有限公司
福斯特	指	杭州福斯特应用材料股份有限公司
指国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

深圳市市监局	指	深圳市市场监督管理局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A股、普通股	指	发行人本次发行的面值为人民币1元的普通股
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人、保荐机构、主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
发行人律师	指	广东信达律师事务所
申报会计师、容诚会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	深圳市容大感光科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市容大感光科技股份有限公司监事会
公司章程	指	深圳市容大感光科技股份有限公司章程
报告期/报告期内	指	2019年、2020年、2021年、 <b>2022年1-9月</b>
最近三年	指	2019年、2020年及2021年
报告期各期末	指	2019年末、2020年末、2021年末及 <b>2022年9月末</b>
最近一期末	指	<b>2022年9月末</b>
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二部分：专业术语

光刻胶	指	又称光刻材料，由树脂、感光剂和溶剂三种主要成份组成的对光敏感的混合液体，主要用于电子信息产业中印制电路板的线路加工、各类显示面板的制作、半导体芯片及期间的微型图形加工等领域
PCB	指	Printed Circuit Board，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板、印刷电路板，重要的电子部件之一，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体
半导体	指	Semiconductor，常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料
IC	指	Integrated circuit，系集成电路
刻蚀	指	系半导体集成电路、平板显示以及微纳制造工艺中的重要步骤
PCB阻焊油墨	指	PCB感光阻焊油墨，用于涂覆在印制电路板表面形成有选择性的、永久性的聚合物保护层的油墨，PCB光刻胶的一种
PCB湿膜光刻胶	指	PCB感光线路油墨，以光成像原理将电子线路图形转移至PCB板上的制作PCB电路图形的油墨，PCB光刻胶的一种

线路油墨	指	以光成像原理将电子线路图形转移至 PCB 板上的制作 PCB 电路图形的油墨
感光干膜、干膜光刻胶	指	用光固化方式进行印刷电路板图形转移的薄膜材料，PCB 光刻胶的一种
LDI	指	Laser Direct Imaging，激光直接成像技术
电子化学品	指	电子工业使用的专用化工材料，即电子元器件、印制线路板、工业及消费类整机生产用的各种化学品及材料，又称电子化工材料
g 线光刻胶	指	主要用于 435nm 光刻工艺中的光刻胶
i 线光刻胶	指	主要用于 365nm 光刻工艺中的光刻胶
KrF 光刻胶	指	主要用于 248nm 光刻工艺中的光刻胶
ArF 光刻胶	指	主要用于 193nm 光刻工艺中的光刻胶
EUV 光刻胶	指	主要用于 7nm 或更小逻辑制程节点的关键制造工序中的光刻胶
物联网、IoT	指	Internet of Things，互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通
树脂	指	高分子化合物，是由低分子原料通过化学反应形成的大分子的产物
单体	指	能参与聚合反应形成高分子树脂的低分子化合物
助剂	指	配制油墨的辅助材料，能改善油墨性能
填料	指	用来着色的粉末状物质，在水、油脂、树脂、有机溶剂等介质中不溶解，但能均匀地在这些介质中分散并能使介质着色，同时具有一定的遮盖力
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计协会的简称，致力于提供全球半导体行业市场统计数据的全局性协会
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体产业协会的简称，致力于促进微电子、平面显示器及太阳能光电等产业供应链的整体发展

注 1：本募集说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入形成。

注 2：如无特殊说明，本募集说明书中的财务数据为合并报表数据。

## 第一节 发行人基本情况

### 一、发行人基本信息

中文名称:	深圳市容大感光科技股份有限公司
英文名称:	Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.,Ltd.
成立日期:	1996年6月25日
上市日期:	2016年12月20日
股票上市地:	深圳证券交易所
股票代码:	300576
股票简称:	容大感光
总股本:	213,454,755股
法定代表人:	黄勇
邮编:	518103
注册地址:	广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)
办公地址:	广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)
联系电话:	0755-27312760
联系传真:	0755-27312759
公司网站:	www.szrd.com
电子邮箱:	samcai@szrd.com
统一社会信用代码:	91440300279247966X
经营范围:	一般经营项目是:印制线路板专用油墨、光刻材料及其配套化学品的研发,精细化工产品的购销;从事货物及技术进出口业务(以上均不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及化学试剂,不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。许可经营项目是:普通货运。

### 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 发行人股本结构和前十大股东

##### 1、发行人股本结构

截至2022年9月30日,公司总股本为213,454,755股,股本结构如下:

序号	股份性质	持股数量(股)	持股数量(%)
有限售条件的股份	1、国家持股	-	-
	2、国有法人持股	-	-

序号	股份性质	持股数量（股）	持股数量（%）
	3、其他内资持股	86,869,484	40.70
	4、外资持股	-	-
	小计	<b>86,869,484</b>	<b>40.70</b>
无限售条件的股份	1、人民币普通股	126,585,271	59.30
	2、境内上市的外资股	-	-
	3、境外上市的外资股	-	-
	4、其他	-	-
	小计	<b>126,585,271</b>	<b>59.30</b>
合计		<b>213,454,755</b>	<b>100.00</b>

## 2、发行人前十大股东持股情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	股份数量(股)	持股比例（%）	其中有限售条件的股份数量(股)
1	林海望	境内自然人	28,003,015	13.12	21,002,261
2	杨遇春	境内自然人	26,256,454	12.30	19,692,340
3	黄勇	境内自然人	25,629,452	12.01	19,222,088
4	刘启升	境内自然人	22,261,628	10.43	16,696,221
5	刘群英	境内自然人	8,838,160	4.14	-
6	魏志均	境内自然人	5,791,524	2.71	4,343,642
7	牛国春	境内自然人	4,326,810	2.03	4,172,675
8	铸锋资产管理（北京）有限公司—铸锋纯钧 12 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	3,662,890	1.72	-
9	铸锋资产管理（北京）有限公司—铸锋纯钧 13 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	2,740,770	1.28	-
10	袁毅	境内自然人	1,674,894	0.78	-
合计			<b>129,185,597</b>	<b>60.52</b>	<b>85,129,227</b>

### （二）控股股东及实际控制人情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人为林海望、杨遇春、黄勇和刘启升。其中：林海望直接持有公司 13.12%的股份，为公司第一大



股东；杨遇春直接持有公司 12.30%的股份，为公司第二大股东；黄勇直接持有公司 12.01%的股份；刘启升直接持有公司 10.43%的股份。林海望、杨遇春、黄勇和刘启升四人合计控制公司 47.86%的股份。其基本情况如下：

(1) 林海望，1962 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为 440103196204\*\*\*\*\*。

(2) 杨遇春，1969 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为 110108196901\*\*\*\*\*。

(3) 黄勇，1969 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为 360103196912\*\*\*\*\*。

(4) 刘启升，1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为 442821197002\*\*\*\*\*。

### 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

#### (一) 发行人所处行业

公司的主营业务为 PCB 光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等电子感光化学品的研发、生产和销售，主要产品为湿膜光刻胶、阻焊油墨、干膜光刻胶、特种油墨、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等系列电子感光化学品。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》，公司业务属于大类“C 制造业”中的子类“C26 化学原料和化学制品制造业”。

#### (二) 行业监管体制和主要法律法规及政策

##### 1、行业主管部门及管理体制

目前，公司所属电子化学品行业主要由政府部门和行业协会共同管理。前者侧重于行业宏观管理，后者侧重于行业内部自律性管理。

公司所属行业的行政主管部门主要为国家发改委、工信部、国家及地方各级环境保护主管部门以及地方各级人民政府相应的行政管理职能部门。其中国家发改委的主要职责为拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经

济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议等；工信部的主要职责是制定产业发展战略、方针政策，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施等。

和发行人密切相关的全国性自律组织主要有中国电子学会（CIE）、中国感光学会（CSIST）、中国电子电路行业协会（CPCA）等，上述协会具有协助政府管理的职能，参与国家和行业标准的制定，协助编制、参与论证国家本行业和关联行业的发展规划，收集汇编行业发展信息等。

中国电子学会（CIE）隶属于国家工信部，下设有电子制造与封装技术分会——印制电路专委会，主要任务包括开展国内外学术、技术交流，推广电子信息技术应用，开展行业决策、技术咨询，研究和推荐电子信息技术标准，鉴定和评估电子信息科技成果等，其中印制电路专委会主要负责协助政府主管部门实施行业管理，组织制定各类行业标准。

中国感光学会（CSIST）是感光行业自律组织，作为中国科学技术协会所属的一级学术组织，下设辐射固化专业委员会，主要负责开展国内辐射固化科技的学术交流，组织重点学术专题讨论和举办相应的科技展览，促进辐射固化科学技术的发展和应用。

中国电子电路行业协会（CPCA）是公司产品 PCB 油墨下游印制电路板行业的自律组织，隶属工信部，是经中华人民共和国民政部批准成立的国家一级行业协会，世界电子电路理事会（WECC）的成员之一，现有会员单位近 800 家，在印制电路板行业具有较高的权威性。

## 2、行业主要政策及法律法规

公司所处电子化学品行业为电子信息与精细化工行业的交叉领域，同时受到两个行业的产业政策的影响。

### （1）主要行业政策

2017 年以来，对行业影响较大的主要行业政策如下表所示：

时间	文件名	颁布单位	主要内容
2021年12月	《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》	国家工信部	将集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂、特种气体等列为重点新材料。
2021年6月	《2021年度实施企业标准“领跑者”重点领域》	市场监管总局	明确规定涂料、油墨、颜料及类似产品为2021年度实施企业标准“领跑者”重点领域
2021年3月	《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	发改委、工信部、财政部等	光刻胶生产企业入围清单,可享受税收优惠政策
2021年3月	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	十三届全国人大第四次会议	聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。
2021年1月	《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》	工信部	突破关键材料技术。支持电子元器件上游电子陶瓷材料、磁性材料、电池材料等电子功能材料,电子浆料等工艺与辅助材料,高端印制电路板材料等封装与装联材料的研发和生产。提升配套能力,推动关键环节电子专用材料研发与产业化
2020年12月	财政部、税务总局等	《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》	国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税;国家鼓励的集成电路线宽小于65纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税;国家鼓励的集成电路线宽小于130纳米(含),且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
2020年12月	《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》	商务部、国家发改委	鼓励外商投资:水性油墨、电子束固化紫外光固化等低挥发性油墨、环保型有机溶剂生产;高性能涂料,高固体份、无溶剂涂料及配套树脂,水性工业涂料及配套水性树脂生产;飞机蒙皮涂料生产,超疏水纳米涂层材料生产。
2020年9月	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	国家发改委、科技部、工信部、财政部	加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定,加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等

时间	文件名	颁布单位	主要内容
			领域实现突破。
2020年9月	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	国家发改委、科技部、工信部、财政部	加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。
2020年8月	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	国务院	给予集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业更有力的税收优惠政策，进一步优化集成电路产业的发展环境。
2020年2月	《加快半导体及集成电路产业发展若干意见的通知》	广东省政府	加快光刻胶、高纯度化学试剂、电子气体等材料研发生产
2019年12月	《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》	工信部	将集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂、ArF光刻胶用脂环族环氧树脂、g/i线正性光刻胶用醛酚树脂列入推荐材料。电子化工新材料，如集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂、LCD用正性光刻胶、新型显示用材料及其关键原材料、高性能水汽阻隔膜等功能薄膜材料等赫然在列。
2019年10月	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	国家发改委	指出新型精细化学品的开发与生产，轻工类中水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨，水性工业用涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化涂料生产等属于鼓励类
2018年12月	《印制电路板行业规范条件》	工信部	加强印制电路板行业管理，引导产业转型升级和结构调整，推动印制电路板产业持续健康发展。
2018年11月	《战略性新兴产业分类（2018）》	国家统计局	包含了“光敏树脂材料（集成电路、印刷线路板制作及电子器件等）”
2017年5月	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》	国家发改委	将光刻胶列入“电子核心产业”的“集成电路”项。

## （2）主要法律法规

公司作为感光电子化学品企业，在日常生产经营活动中还应当遵循《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《建设项目环境保护管理条例》等关于产品质量和新建项目的环境保护等要求。

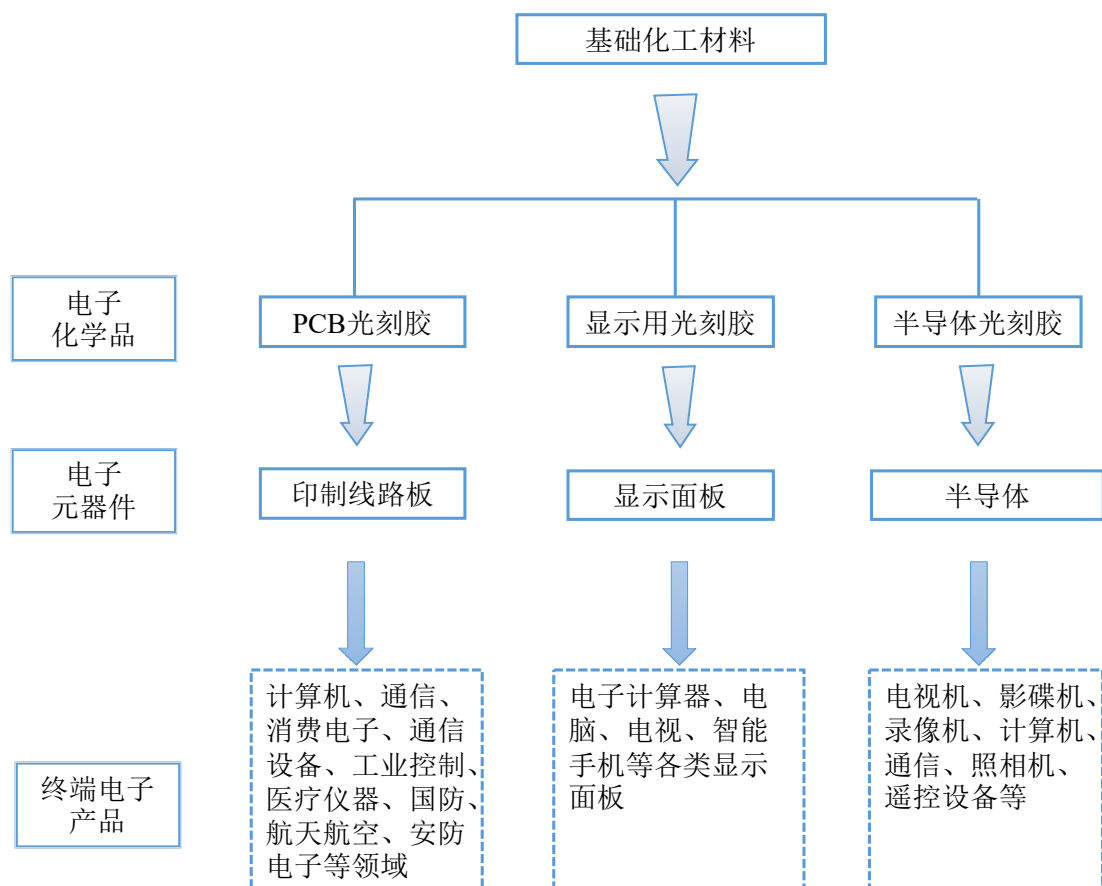
### 3、行业政策对发行人经营发展的影响

光刻胶是光刻工艺中的关键材料，当前被广泛应用于半导体、显示、PCB等领域，并最终广泛应用于消费电子、**通讯**、汽车、航空航天、军事装备等关乎国民经济、工业发展的关键行业，产业链自主可控的需求迫切。在此背景下，以光刻胶为代表的**关键电子材料**的发展已提升到国家战略高度，我国密集出台一系列政策，大力支持行业的发展，鼓励国产化替代，促进产业链自主可控。近年来我国出台的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》等多项鼓励光刻胶产业发展的政策，为公司创造更多的发展机会，建立了良好的外部政策环境。

#### （三）行业发展现状和发展趋势

##### 1、发行人所处行业在产业链的位置

公司所处电子化学品行业的上游行业是基础化工材料行业，下游行业为印制线路板、显示面板和半导体等电子信息行业。公司主要产品为光刻胶，按照下游应用领域划分，光刻胶主要可以划分为PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶。



在国家政策支持、下游市场发展、持续研发投入等因素的综合影响下，我国光刻胶行业市场规模增长迅速。在 PCB、显示面板和半导体产业国产化进程加速、产业链自主可控需求迫切的背景下，作为上游关键材料的光刻胶呈现明显的进口替代趋势，国产光刻胶或将迎来快速发展的机遇。

## 2、行业发展现状与发展趋势

光刻胶是指通过紫外光、电子束、离子束、X 射线等照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料。光刻胶的主要作用是利用光化学反应将光刻系统中经过衍射、滤波后的光信息转化为化学能量，从而把微细图形从掩模版转移到待加工基片上。按照下游市场需求，光刻胶可分为 PCB 光刻胶、显示用光刻胶和半导体光刻胶三大类。

### (1) PCB 光刻胶

PCB 光刻胶主要用于 PCB 制造过程的图案化工艺，主要分为干膜光刻胶、湿膜光刻胶、阻焊油墨。各类 PCB 光刻胶的简介如下：

类别名称	简介
湿膜光刻胶	又称感光线路油墨，液态光刻胶均匀涂抹在覆铜板上，经过曝光、显影、刻蚀等工序形成铜线路。材料成本比干膜低，但是加工设备成本较高。可进一步细分为内层感光线路油墨和外层感光线路油墨。
干膜光刻胶	由配置好的液态光刻胶均匀涂抹在载体 PET 薄膜上，经过烘干、冷却后，盖上 PE 薄膜，收卷而成。在使用时，将干膜光刻胶压在覆铜板上，经过曝光显影将电路图转移到 PCB 板上。通过后续对覆铜板刻蚀加工，形成 PCB 上的铜线路。
阻焊油墨	用于涂覆在印制电路板表面形成有选择性的、永久性的聚合物保护层的油墨，防止在焊锡过程中造成的短路，保证 PCB 在运输、存放、使用时的安全性。进一步可以细分为 UV 固化阻焊油墨和液态感光阻焊油墨，UV 固化油墨可用在对精度要求不高的 PCB 上，附着力较差；感光阻焊油墨则精密度较高。

PCB 是电器安装和元器件连接的基板，是电子工业最重要的基础电子部件之一，在下游电子产品生产过程中具有必要性和不可替代性。PCB 光刻胶通常占 PCB 制造成本的 3%。

近年来，随着电子技术的迅猛发展，PCB 逐渐从单面板发展到双面板、多层板、柔性板，并且不断向高精度、高密度和高可靠性方向发展。为了适应 PCB 的发展趋势，与之相适应的 PCB 光刻胶等各种电子化学品也得到了不断的创新和发展。同时，5G 商用化带来了通信系统、网络和终端设备的升级需求，在人工智能、物联网等技术不断完善的背景下，终端设备呈现网络化、智能化趋势。通讯、消费电子、计算机、汽车电子等下游应用领域的蓬勃发展带动 PCB 需求的逐年上升。据 Prismark 公布数据，2016 至 2021 年全球 PCB 行业市场规模从 533.6 亿美元增长至 809.20 亿美元，年复合增长率为 7.19%；预计 2026 年市场规模将增长至 1,015.59 亿美元，2021 年至 2026 年复合增长率预计达 4.60%。2016 至 2021 年中国（不包含港澳台地区）PCB 行业市场规模从 271 亿美元增长至 442 亿美元，年复合增长率为 8.49%，随着我国 PCB 产值的不断增加，PCB 光刻胶的需求量亦将稳步增长。

## （2）显示用光刻胶

显示用光刻胶主要用于平板显示、显示器、LCD、OLED、触摸屏等产品的生产，使用的光刻胶品种根据应用工艺不同主要分为彩色光刻胶、黑色光刻胶、TFT 阵列用光刻胶、触摸屏用光刻胶等。

各类主要显示用光刻胶的简介如下：

类别名称	简介
TFT 阵列用光刻胶	用在 TFT 基板上形成设计好的阵列图形以便控制液晶运动，主要应用于 TFT-LCD 或 AMOLED 制造中的阵列段，包括 TFT 的图案化光刻胶，保护绝缘层光刻胶，ITO 图案化光刻胶，OLED 阵列中平坦层光刻胶等
彩色光刻胶、黑色光刻胶	主要用于彩色滤光片制作，彩色光刻胶分为红、绿、蓝三原色光刻胶，经过涂抹、曝光、显影等工序组成了颜色层，彩胶在显示用光刻胶中占比超过 50%；黑色光刻胶则用于形成黑色矩阵，起到防止漏光的作用。
触摸屏用光刻胶	主要用于在玻璃基板上沉积 ITO 制作触摸电极。

在显示领域，随着家用电器、消费电子、汽车电子等行业的发展，以及电视、显示器、智能手机等应用大尺寸化趋势延续，显示行业的市场需求持续增长。根据 Frost & Sullivan 统计，2015 年至 2020 年，按照产量口径，全球显示面板行业市场规模从 1.72 亿平方米增长至 2.42 亿平方米，年均复合增长率为 7.1%。随着显示面板技术的发展和下游需求的增长，预计 2024 年全球显示面板市场规模将达到 2.74 亿平方米。根据 DSCC 预测，中国（不包含港澳台地区）面板产能份额将从 2020 年 53% 提升至 2025 年 71%。

自 2010 年以来，以京东方为首的国内 LCD 厂商迅速崛起，加上韩国厂商将部分重心转移到 OLED，中国 LCD 面板产能达到全球第一。根据中国产业信息网、国泰君安证券研究所数据，预计 2020 年至 2023 年，国内 LCD 光刻胶市场规模将从 40 亿增长到 68 亿元，年复合增长率为 19.3%。

### （3）半导体光刻胶

半导体光刻胶主要用于分立器件、LED、集成电路等产品的生产，半导体光刻胶随着市场对半导体产品小型化、功能多样化的要求，而不断通过缩短曝光波长提高极限分辨率，从而达到集成电路更高密度的集积。按照曝光波长，半导体光刻胶可分为紫外宽谱（300-450nm）、g 线（436nm）、i 线（365nm）、KrF（248nm）、ArF（193nm）、EUV（13.5nm）等 6 个主要品类。

根据 SEMI、中泰证券研究所数据，2021 年，全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，2015-2021 年复合增长率为 12.03%。2021 年，中国（不包含港澳台地区）半导体光刻胶市场规模达到 4.93 亿美元，同比增长 43.69%。



## （四）行业特点

### 1、行业竞争格局及行业内主要企业

#### （1）PCB 光刻胶

近年来，随着全球制造产业向中国加速转移，国内 PCB 制造业发展较快，以发行人为代表的国内民营 PCB 光刻胶供应商逐步发展壮大。经过多年的研发及技术积累，部分国内供应商逐步掌握了湿膜光刻胶关键原材料合成树脂的合成技术，改变了过去对进口合成树脂的依赖。同时，国内企业通过对合成树脂的自研、自产、自用，有效降低了产品成本，形成较为明显的价格竞争优势。根据方正证券研究所数据，2020 年湿膜光刻胶和阻焊油墨国产化率约 50%。

PCB 光刻胶的市场格局主要呈现日本、中国台湾地区、中国大陆三足鼎立的形势。日本企业中太阳油墨占据龙头地位，市场占有率相对较高。在湿膜光刻胶及阻焊油墨市场方面，容大感光、广信材料、广东炎墨等本土企业占据国内市场约 50%的份额，外资厂商主要包括太阳油墨。

在干膜光刻胶方面，中国（不包含港澳台地区）干膜光刻胶市场仍高度依赖进口，中国（不包含港澳台地区）的感光干膜生产企业主要有福斯特、五江高科。

#### （2）显示用光刻胶及配套化学品

全球黑色光刻胶及彩色光刻胶市场主要由日本、韩国和中国台湾企业主导。根据中金公司研究所数据，彩色光刻胶主要生产企业包括日本 JSR、东洋油墨、住友化学，三者全球市场占有率约 55%，黑色光刻胶市场主要由三菱化学、日本 TOK 占据，全球市场占有率约 2/3，黑色光刻胶及彩色光刻胶的其他生产企业包括韩国三星 SDI、LG 化学（彩胶事业部于 2020 年被雅克科技收购）和中国台湾的达兴材料等。TFT 正性光刻胶方面，由于其与低端半导体光刻胶分辨率和显影效果类似，因此国内部分半导体光刻胶厂商亦可生产 TFT 正性光刻胶。

#### （3）半导体光刻胶及配套化学品

根据前瞻研究院数据，全球半导体光刻胶市场基本被日本和美国企业所壟

断，2020年TOL、美国杜邦、JSR、住友化学市场占有率分别为25.6%、17.6%、15.8%和10.4%，行业集中度高。目前国内高端半导体光刻胶产品尚需依赖进口。

半导体光刻胶及配套化学品市场集中于美、日、欧少数大厂商手中，国内从事光刻胶及配套化学品研究、开发及生产的厂商较少。公司光刻胶产品的主要竞争对手包括日本TOK、美国杜邦、日本JSR、住友化学、北京科华、苏州瑞红。

## 2、行业进入壁垒

### (1) 技术壁垒

电子化学品系化学、材料学、电子科学等多学科相结合的综合学科领域，具有高度专用性、应用领域集中的特性。各种电子化学品之间在材料属性、生产工艺、功能原理、应用领域之间差异较大，产品之间专业跨度大，市场细分程度高，且行业内龙头企业就相关技术构建了专利壁垒，因此电子化学品企业在新产品开发过程中面临较高技术壁垒。另一方面，信息通讯、消费电子等下游行业的快速发展，势必要求电子化学品更新换代速度不断加快，这对企业研发人员、技术人员具备多种科学知识及掌握上下游行业的综合性科学知识提出了较高要求。

此外，随着环保意识不断加强，世界各国对电子零部件的环保要求也愈发严格，纷纷以立法方式限制电子产品中的污染及有害物质的使用。电子化学品行业企业为了满足终端产品的环保要求，必须拥有以高技术作支撑的强大创新研发能力，才能在满足环保要求的前提下开发出性能和质量均能满足下游客户需求的产品。

### (2) 人才壁垒

电子感光化学品属于高端新型材料，其研究开发人员需要具备丰富的电子感光化学品研制经验并具备光化学、有机合成化学、分析化学及半导体、平板显示应用等多种学科知识。在生产上，由于生产工艺的复杂性，需要对生产过程进行精密控制，一名合格的工程人员不仅必须具备扎实的理论基础，并且需要具有产业化生产的丰富经验。由于本土从事光刻胶生产研发的企业较少，此

类人才极为短缺，因此新进者面临较高的人才壁垒。

### **(3) 客户壁垒**

尽管电子化学品在下游电子信息产业的成本占比较小，但电子化学品任何参数、性能、品质的变化，都可能对下游产品质量产生重要影响，因此下游企业对通常对原材料供应商及其产品的选择较为审慎、严格，设置了一系列审核评估及小试、中试等测试流程。确认合作关系后，下游企业还会对产品持续完善能力和相关售后服务进行跟踪评价，整个供应商考察周期较长，一旦被选入其供应体系，就不会轻易变更，形成长期稳定的合作关系，从而形成了较高的客户壁垒，使得其他潜在竞争对手短期内难以进入。

### **(4) 资金壁垒**

首先，电子化学品行业生产过程对于原材料、生产环境、生产工艺要求较高，企业在原材料采购、厂房设计及建设、生产设备采购等方面均需要投入大量资金；其次，电子化学品行业处于电子信息产业链的前端，销售回款普遍较慢，需要企业拥有一定规模的营运资金；最后，由于行业存在的技术壁垒，要求企业必须拥有持续创新能力以保持市场竞争力，在研发软硬件投入方面的资金需求较大。综上，电子化学品在生产、运营和研发等方面的大量资金需求对新进入企业形成了一定壁垒。

## **四、主要业务模式、产品或服务的主要内容**

### **(一) 主要产品及其用途**

公司的主营业务为 PCB 光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等电子感光化学品的研发、生产和销售，主要产品为湿膜光刻胶、阻焊油墨、干膜光刻胶、特种油墨、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等系列电子感光化学品。电子化学品泛指为下游电子工业配套使用的精细化工材料，是电子材料与精细化工相结合的高新技术产品，其应用的终端产品几乎覆盖整个电子信息产业，包括信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子、节能照明、自动控制、航空航天、国防军工等领域。公司产品主要应用在 PCB、显示、半导体等领域。

公司 PCB 光刻胶产品以湿膜光刻胶、阻焊油墨为主。公司的湿膜光刻胶具

备感光速度快、解像度高、附着力好、容易褪膜等特点；阻焊油墨除具备常规性能外，还有工艺使用宽容度大、耐热冲击性好、批次稳定性高等特点。

公司的显示用光刻胶的产品主要为触摸屏 sensor 用光刻胶，主要应用于触摸屏制作，具备高分辨率、高均一性的特点。公司的半导体光刻胶产品主要为 g 线光刻胶和 i 线光刻胶，主要应用于半导体分立器件、集成电路产品生产流程中的光刻工艺，具备耐热性好、刻蚀效率较高的特点。

公司的特种油墨产品主要用于触摸屏、视窗玻璃、智能手机等产品的精密加工领域。

公司的主要产品的功能、应用领域情况如下：

产品系列	产品类别	代表产品	主要功能	应用领域
PCB 光刻胶	湿膜光刻胶	普通内层感光线路油墨 LDI 内层感光线路油墨 外层感光线路油墨	将电子线路图形转移到 PCB 板上	PCB 制造
	阻焊油墨	丝网印刷型感光阻焊油墨 喷涂感光阻焊油墨 车载 PCB 板感光阻焊油墨 LED 板用白色感光阻焊油墨	可对所覆盖精密电子线路发挥绝缘、防潮、防高温、防腐蚀等保护作用	
	干膜光刻胶	抗电镀干膜光刻胶 精细线路干膜光刻胶	可将电子线路图形转移到 PCB 板上	
	其他油墨	喷印紫外光固化文字油墨	可将图形转移到 PCB 板上	
显示用光刻胶、 半导体光刻胶 及配套化学品	显示用光刻胶	触摸屏 sensor 用光刻胶	将掩膜版上的图形转移到基材上	半导体、显示面板制造等领域
	半导体光刻胶	g 线光刻胶 i 线光刻胶	将掩膜版上的图形转移到基材上	
	配套化学品	电子级稀释剂 电子级清洗剂	调节光刻胶粘度、清洗基材适应各种工艺要求	
特种油墨	客户定制	玻璃盖板切割保护油墨 精密五金件制造油墨	精密加工过程中，对玻璃、五金件起到保护作用	触摸屏、视窗玻璃、智能手机等金属精密加工

## （二）主营业务收入情况

报告期内，发行人主营业务收入按照产品类别划分的具体构成如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

项目	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
阻焊油墨	38,019.39	70.41%	56,973.35	72.64%	36,279.99	66.87%	30,870.59	68.15%
湿膜光刻胶	11,223.49	20.79%	14,817.62	18.89%	12,396.25	22.85%	9,694.65	21.40%
干膜光刻胶	923.37	1.71%	112.59	0.14%	-	-	-	-
其他油墨	1,302.49	2.41%	2,132.68	2.72%	1,770.05	3.26%	1,466.51	3.24%
<b>PCB光刻胶合计</b>	<b>51,468.74</b>	<b>95.32%</b>	<b>74,036.24</b>	<b>94.39%</b>	<b>50,446.29</b>	<b>92.98%</b>	<b>42,031.75</b>	<b>92.79%</b>
显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品	2,136.70	3.96%	2,997.57	3.83%	2,533.01	4.67%	2,107.59	4.66%
特种油墨	389.15	0.72%	1,393.52	1.78%	1,274.41	2.35%	1,159.48	2.56%
<b>主营业务</b>	<b>53,994.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>78,427.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,253.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,298.83</b>	<b>100.00%</b>

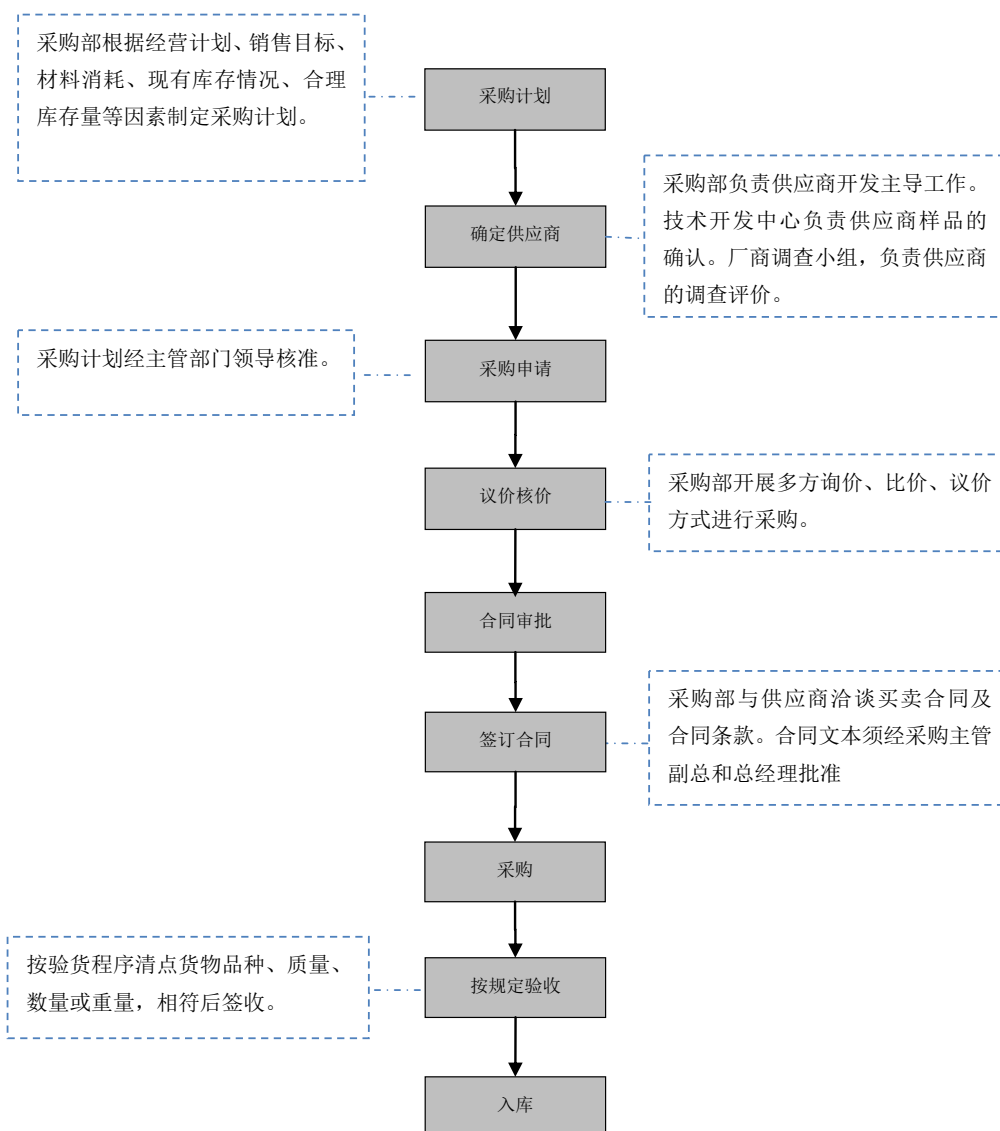
报告期内，发行人主营业务收入主要来源于阻焊油墨、湿膜光刻胶、干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品的销售，报告期内这四类收入的合计分别是 42,672.83 万元、51,209.25 万元、74,901.13 万元及 **52,302.95 万元**，占主营业务收入比例分别为 94.21%、94.39%、95.51%及 **96.87%**，占主营业务收入比重始终保持在 90%以上。报告期内，发行人主要产品的销售收入构成总体保持稳定。

### （三）主要业务经营模式

#### 1、采购模式

公司主要原材料为树脂、单体、溶剂、助剂、颜填料等，大部分原材料采用向生产厂家直接采购的模式，部分进口树脂、助剂在经销商处采购。公司建立了严格的采购管理制度。

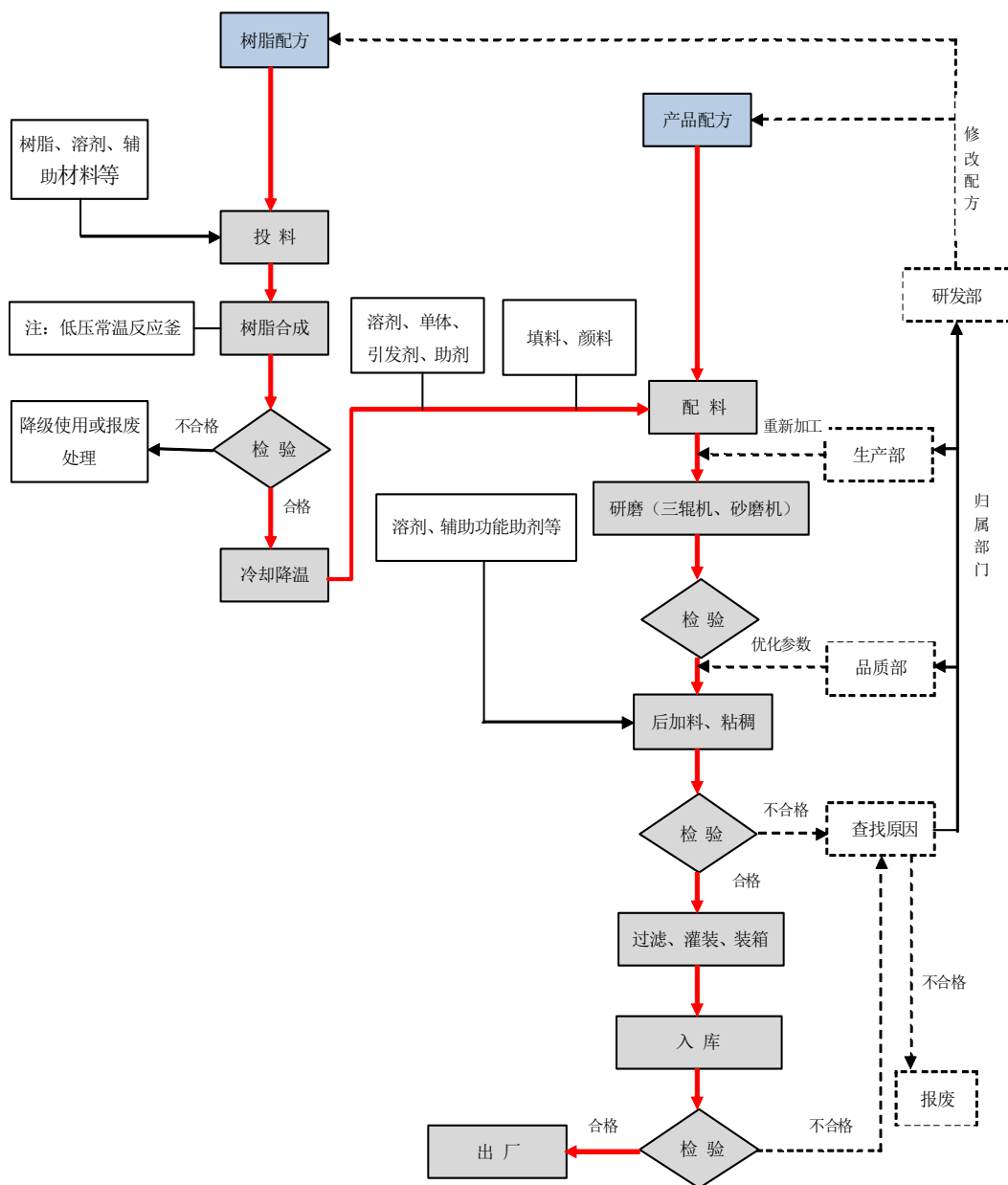
公司采购流程如下图所示：



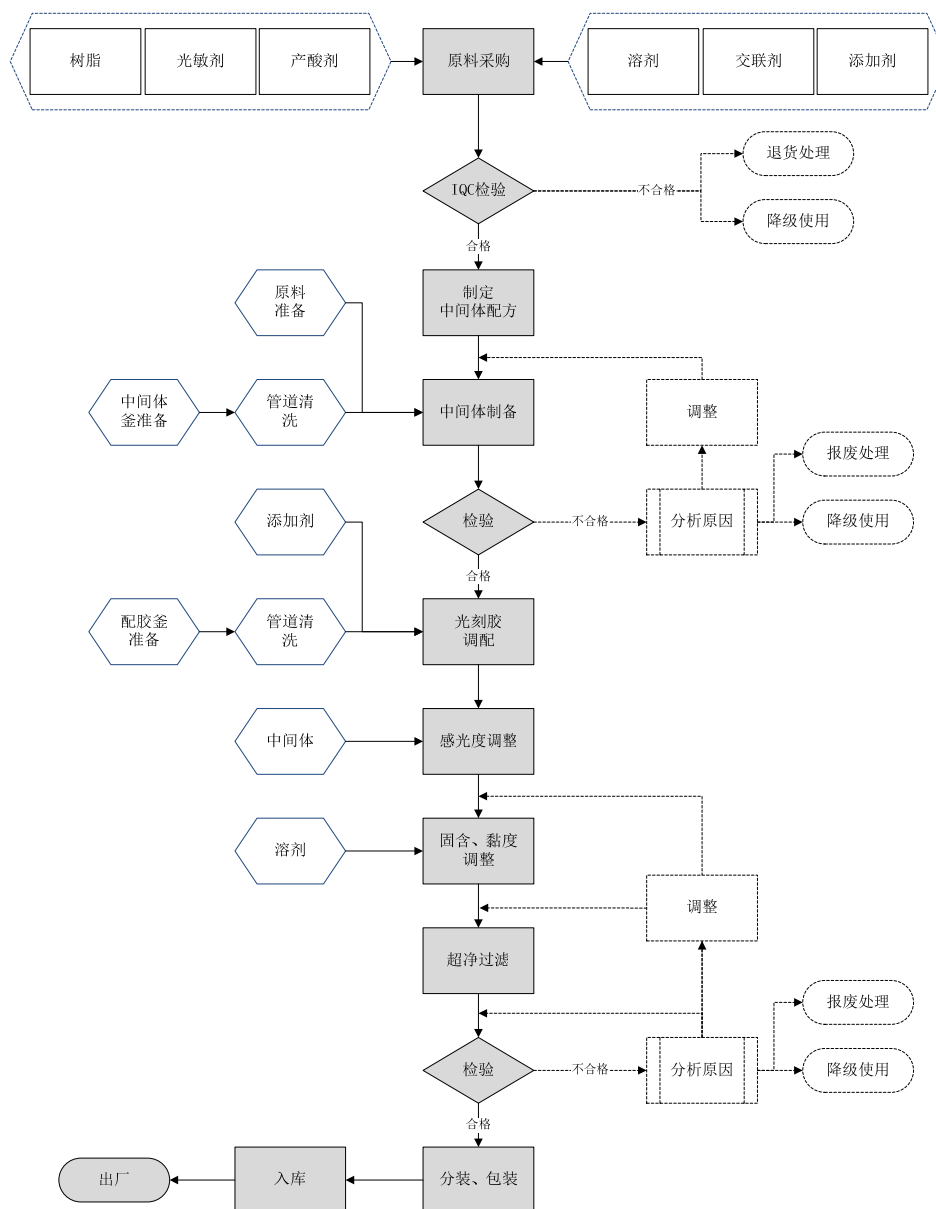
## 2、生产模式

目前，公司产品主要由全资子公司惠州市容大感光科技有限公司、高仕电研负责生产。公司主要根据市场需求、产品库存和往期销售情况，制定生产计划。对于少数特种油墨产品，公司根据客户订单的个性化需求，安排生产计划。

报告期内，公司的PCB感光油墨的产品生产流程如下图所示：



公司的光刻胶产品生产流程如下图所示：

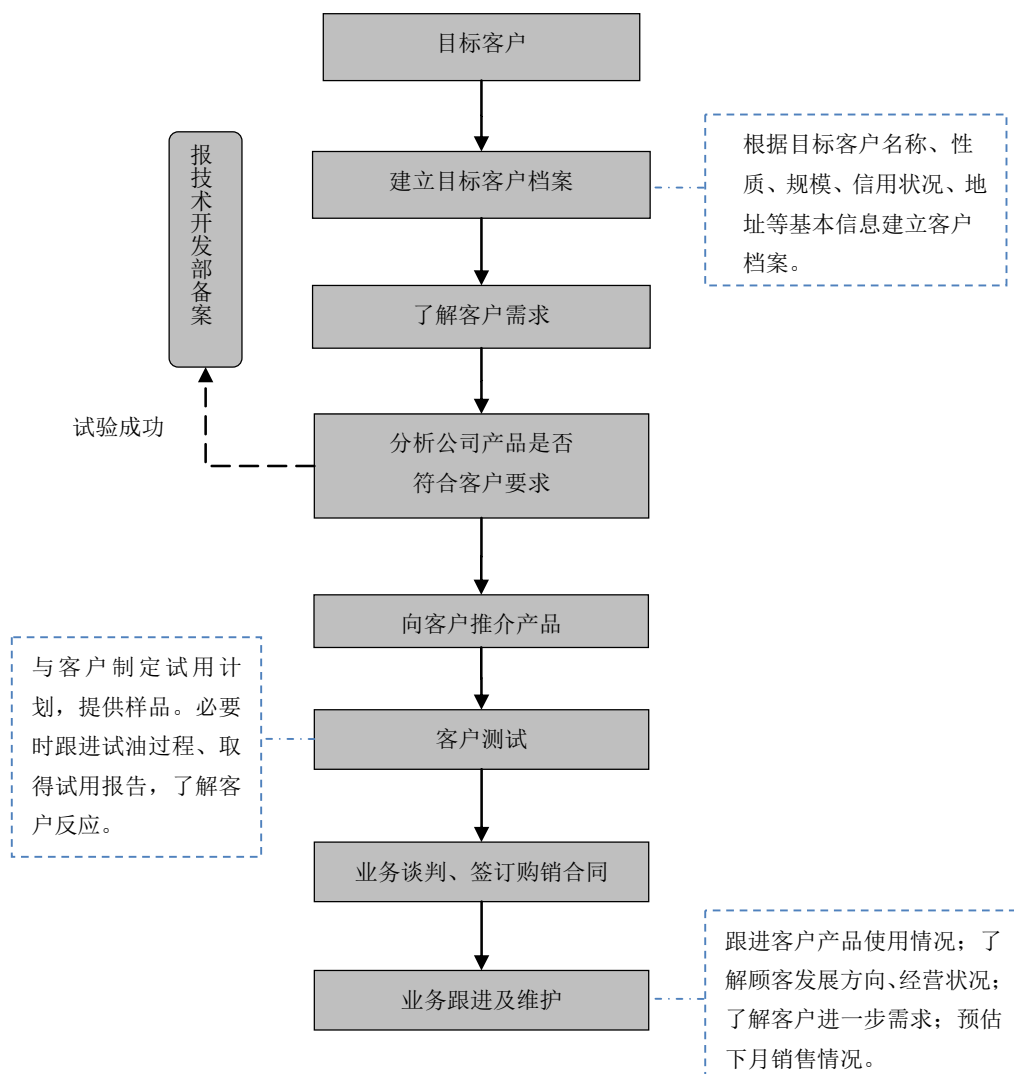


### 3、销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的模式开展销售，其中公司全资子公司高仕电研主要采取直销与经销相结合的模式，除高仕电研外公司主要采取直销模式。

公司主要销售流程如下图所示：





#### (四) 公司主要产品的产能、产量和销量

##### 1、PCB 光刻胶

报告期内，公司主要产品 PCB 光刻胶（含特种油墨）的产能、产量、销量情况如下：

单位：吨

项目	2022 年 1-9 月	2021 年	2020 年	2019 年
产能	15,750.00	21,000.00	18,000.00	18,000.00
产量	14,251.60	20,937.80	15,487.45	13,484.75
销量	13,297.47	20,678.47	15,600.25	13,117.41
产能利用率	90.49%	99.70%	86.04%	74.92%
产销率	93.31%	98.76%	100.73%	97.28%

注：产能为公司环评批复产能的合计。

报告期内公司 PCB 光刻胶产能利用率分别为 74.92%、86.04%、99.70%和

90.49%。报告期内，公司主要根据市场需求、产品库存和往期销售情况制定生产计划。2019年至2021年公司产能利用率有所上升，主要原因系下游PCB行业持续增长、且产能向中国转移，公司产品销量均持续增长，带动产能利用率提升；2022年1-9月，公司产能利用率略有下降，主要受当期下游行业景气度下滑、市场需求下降，导致当期产量下降、产能利用率降低。

## 2、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品

报告期内，公司主要产品显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品的产能、产量、销量情况如下：

单位：吨

项目	2022年1-9月	2021年	2020年	2019年
产能	787.50	1,050.00	1,050.00	1,050.00
产量	208.28	298.64	245.96	197.11
销量	203.77	300.53	245.00	182.17
产能利用率	26.45%	28.44%	23.42%	18.77%
产销率	97.83%	100.63%	99.61%	92.42%

注：产能为公司环评批复产能的合计。

报告期内公司显示用、半导体光刻胶及配套化学品产能利用率分别为18.77%、23.42%、28.44%和**26.45%**。报告期内，公司显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品产能利用率较低，主要原因系：

①显示用及半导体光刻胶的产品开发和验证开发周期较长，需要不断与下游客户进行合作验证和产品推广，验证周期通常耗时6-24个月，过程中需要根据下游客户的特定需求进行反复调试和修改配方。

②显示用及半导体光刻胶产品主要目标客户分别为大型显示面板企业和半导体制造企业，供货保障能力是大型企业筛选供应商的重要标准之一，发行人现有产能规模较小，限制了开拓大客户的能力。

## （五）公司主要原材料及能源情况

### 1、主要原材料采购情况

报告期内，公司主要原材料采购情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
树脂	10,515.28	31.31%	17,204.83	32.73%	9,736.06	30.64%	9,202.73	30.85%
助剂	7,437.91	22.15%	10,417.61	19.82%	7,206.76	22.68%	7,463.10	25.02%
溶剂	4,721.50	14.06%	9,119.28	17.35%	5,295.78	16.67%	4,490.83	15.06%
单体	4,706.63	14.02%	6,830.08	12.99%	4,003.30	12.60%	3,637.33	12.19%
颜填料	3,836.48	11.43%	5,526.84	10.51%	3,251.97	10.23%	2,954.06	9.90%
合计	31,217.80	92.97%	49,098.63	93.40%	29,493.87	92.82%	27,748.05	93.02%

报告期内，公司对主要原材料的采购数量随着公司产销规模的扩大而增加，主要原材料采购金额及占比变化主要系各原材料价格波动所致，原材料采购占比情况总体较为稳定。

## 2、主要能源的使用情况

报告期内，发行人主要使用的能源为电力和天然气，电力采购的变化情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
电力	538.88	672.62	654.40	490.53
水	6.27	7.19	13.32	16.00
天然气	34.74	51.16	-	-

公司及子公司生产所需的电力由当地供电公司供应，电力供应总体充足，能够保证公司的正常生产经营。

## 五、发行人主要固定资产及经营资质状况

### （一）主要固定资产

发行人拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、办公设备及其他、生产设备、研发设备和运输工具等，目前使用状况良好。截至2022年9月30日，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
----	----	------	--------	-----

类别	原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
房屋及建筑物	11,239.74	2,924.55	8,315.20	73.98%
办公设备及其他	709.09	666.28	42.81	6.04%
生产设备	7,288.10	2,658.87	4,629.23	63.52%
研发设备	2,072.15	1,038.57	1,033.58	49.88%
运输工具	607.75	336.97	270.78	44.55%
合计	21,916.83	7,625.25	14,291.59	65.21%

## 1、房屋及建筑物

### (1) 已办证房产

截至本募集说明书签署日，公司及子公司拥有产权证书的房产情况如下：

序号	所有权人	房地产证号	登记时间	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	地类	是否 抵押
1	容大感光	深房地字第 5000528881	2012.6.1	宝安区新安 街道前进路 东侧	379.74	商住混 合用地	否
2	惠州容大	粤房地权证惠东 字第 0110016535号	2012.1.4	惠州市惠东 县稔山镇海 滨城开发区 (厂房)	810.00	工业	否
3	惠州容大	粤房地权证惠东 字第 0110016546号	2012.1.4	惠州市惠东 县稔山镇海 滨城开发区 (电机房)	60.06	工业	否
4	惠州容大	粤房地权证惠东 字第 0110016548号	2012.1.4	惠州市惠东 县稔山镇海 滨城开发区	1,181.00	工业	否
5	惠州容大	粤房地权证惠东 字第 0110016549号	2012.1.4	惠州市惠东 县稔山镇海 滨城开发区 (办公楼)	4,828.48	工业	否
6	惠州容大	粤房地权证惠东 字第 0110016552号	2012.1.4	惠州市惠东 县稔山镇海 滨城开发区 (厂房)	2,309.01	工业	否
7	惠州容大	粤房地权证惠东 字第 0110016554号	2012.1.4	惠州市惠东 县稔山镇海 滨城开发区 (宿舍)	1,951.96	工业	否
8	苏州容大	苏房权证吴江字 第 25100942	2015.12.11	松陵镇吴江 经济开发区 泉宏路南侧	5,275.55	工业	否
9	苏州容大	苏房权证吴江字 第 25100943	2015.12.11	松陵镇吴江 经济开发区	3,400.56	工业	否

序号	所有权人	房地产证号	登记时间	房屋坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	地类	是否 抵押
				泉宏路南侧			

截至本募集说明书签署日，发行人上述房屋已取得完备的权属证书，房屋权属清晰，不存在查封、扣押等权利受到限制的情形。

## (2) 未办证房产

截至本募集说明书签署日，公司及子公司正在使用的部分房产尚未取得产权证书，具体情况如下：

序号	实际 使用人	房屋坐落	建筑物名称	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	办证进展
1	惠州科技	惠州大亚湾石化区 L3 地块南、天度路以西	办公楼	生产配套	1,764.9	正在办理竣工验收手续
2			门卫	生产配套	18	
3			公用工程房	生产经营	336	
4			油墨车间	生产经营	12,142.3	
5			合成车间	生产经营	3,091.54	
6			光刻胶车间	生产经营	2,771.32	
7			甲类仓库	生产经营	874.16	
8			丙类仓库 A	生产经营	4,198.44	
9			丙类仓库 B	生产经营	2,483.52	
10			甲类埋地储罐区	生产经营	-	
11			泵区	生产经营	-	
12			消防水池	生产配套	-	
13			循环水池	生产配套	-	
14			应急水池	生产配套	-	
15			污水预处理池	生产配套	-	
合计				-	27,680.18	-

截至本募集说明书签署日，惠州科技已取得惠州大亚湾经济技术开发区住房和城乡建设局出具的《建设工程竣工联合验收意见书》，并完成竣工验收备案，正在申请办理相关房屋所有权登记手续，产权证书的办理预计不存在实质障碍。

报告期内公司及子公司未因上述无证房产事项受到主管部门的处罚。截至本募集说明书签署日，公司及子公司正在积极推进产权证书的办理，主要无证房产所在地的主管部门已出具相关合规证明，且实际控制人作出了承担相关损失

的承诺，因此，公司及子公司上述无证房产不能继续使用、被强制拆除或者被采取行政处罚的风险较小，不会对公司持续经营造成重大不利影响。

## 2、主要机器设备构成情况

截至2022年9月30日，公司及子公司单台账面原值100万元以上的机器设备情况如下：

单位：万元

序号	设备名称	数量（台）	设备原值	设备净值	设备综合成新率
1	半成品釜	2	275.14	212.00	77.05%
2	成品釜	2	224.20	172.75	77.05%
3	曝光机	1	188.03	49.82	26.50%
4	扫描电子显微镜	1	152.14	96.80	63.63%
5	树脂釜	1	121.03	93.26	77.06%

### （二）主要业务资质

截至本募集说明书签署日，为开展生产经营活动，发行人及子公司已取得与生产经营业务相关的资质或证书如下：

序号	资质或证书	编号	取得日期	有效期至	取得主体
<b>高新技术企业证书</b>					
1	高新技术企业证书	GR202044202024	2020年12月	2023年12月	容大感光
2	高新技术企业证书	GR201944001630	2019年12月	2022年12月	高仕电研
<b>管理体系认证证书</b>					
1	IATF 16949:2016 质量管理体系认证证书	BSI 证书编号：745491； IATF 证书编号： 0404980	2021年6月	至2024年6月	惠州科技
2	ISO 9001:2015 质量管理体系认证证书	FM 745494	2021年6月	至2024年6月	
3	ISO 14001:2015 环境管理体系认证证书	EMS 745493	2021年6月	至2024年6月	
4	IATF 16949:2016 质量管理体系认证证书	NQA 证书编号： T87755；IATF 证书编 号：0418049	2021年8月	2024年8月	高仕电研
5	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证证书	U20Q2GZ8006725R1M	2020年7月	2023年7月	
6	GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证证书	U20E2GZ8006726R1M	2020年7月	2023年7月	
7	GB/T 29490-2013 知识产权管理 体系认证证书	18120IP0317R1M	2020年11月	2023年11月	

## 六、发行人生产水平及技术特点

公司通过多年的行业实践与持续研发积累了多项核心技术，公司的核心技术均系自主研发取得，已取得核心技术如下：

核心技术名称	特点及优势	应用产品	取得方式
树脂合成技术	树脂是决定光刻胶产品性能最核心的材料。树脂合成技术是指运用化学分子结构原理、合成工艺控制技术，根据实际产品的应用要求及性能要求而设计的具有特定分子结构的可满足特定应用要求的制造技术。 截至本募集说明书签署日，公司拥有感光线路油墨树脂、感光阻焊油墨树脂、柔性 LED 板用阻焊油墨树脂、耐高温不黄变高透光率树脂等合成技术。	PCB 湿膜光刻胶、阻焊油墨	自主研发
配方设计技术	公司湿膜光刻胶配方技术可以平衡解析度、抗蚀刻性和退膜速度等各个性能，以满足不同客户的性能要求。公司阻焊油墨的配方技术可以实现客户对耐化学、绝缘、防潮、耐热等不同性能的要求，可以满足不同工艺对产品在不同时间宽容度、感光速度、紫外光透明性、显影性、表面张力、附着力、收缩应力和表面硬度等方面的要求。 公司的显示用及半导体用光刻胶配方技术可以根据客户对应用分辨率、宽容度、抗蚀比、对比度、灵敏度、粘度等性能的不同要求，优选合适的树脂、溶剂、助剂以及微量添加剂定量添加等，调配出不同工艺需求的光刻胶产品。	PCB 光刻胶、显示用光刻胶及半导体光刻胶	自主研发
工艺控制技术	公司通过生产工艺中设备选型、材质选择，以及分散研磨时间、温度及湿度控制等生产工艺过程控制的关键技术，能够有效提高产品一致性、批次稳定性、良品率、可储存性等。	PCB 光刻胶、显示用光刻胶及半导体光刻胶	自主研发

## 七、现有业务发展安排及未来发展战略

### （一）现有业务发展安排

公司以成为“全球领先电子感光化学品解决方案提供商”为战略目标，以技术创新为引领，以现有业务资源、产品技术为基础，持续加强产品研发和工艺改进，积极建设新增产能。

目前，公司现有业务发展安排如下：

1、产品验证和推广：进一步加强感光干膜、显示用光刻胶等产品的研发和市场推广，积极开拓潜在客户，根据客户需求修改配方和完善工艺，加快客户

验证。

2、市场和客户：巩固并加强与现有客户的深度合作，积极开发战略客户，不断开拓市场，积累优质客户资源，进一步提高公司的竞争优势。

3、新产品研发与量产：持续加强研发和技术创新，加快 IC 载板光刻胶、数码喷印阻焊油墨、彩色、黑白及透明光刻胶等产品的研发与量产，不断拓宽公司产品矩阵，满足市场需求。

## **（二）未来发展战略**

公司以成为“全球领先电子感光化学品解决方案提供商”为战略目标，以技术创新为引领，以现有业务资源、产品技术为基础，秉承“诚实守信，锐意创新，海纳百川，有容乃大”的宗旨，坚持不断创新，紧紧把握电子感光化学品行业发展脉搏，不断巩固并扩大在产品品质、技术研发等方面的优势，缔造具有国际竞争力的高端电子感光化学材料品牌。

## **（三）公司发展计划**

电子产品呈现明显的小型化、轻量化、薄型化、高性能化、多功能化发展趋势。因此，电子化学品生产企业必须通过自主研发不断对其产品进行改造升级，及时根据下游产业技术发展趋势推陈出新，才能满足日益变化的下游市场需求。随着各国对电子化学品的环保要求日趋严格，未来电子化学产品将向无毒、减少粉尘污染、减少溶剂挥发等方向发展，环保型产品将逐渐成为市场主体。为此，公司将持续加强研发创新、不断加大开发新产品、积极扩产降本、持续做好客户服务，进一步提高公司的市场竞争力。

### **1、持续加强产品研发和工艺改进**

公司始终致力于研发创新，以不断研发出适合市场需求的高端感光化学材料为目标，紧跟行业前沿新技术、新趋势，持续加强研发和技术创新，构建公司技术壁垒；提高产品开发能力，不断研发满足行业新需求的新产品，拓宽产品的应用领域。持续进行生产工艺研发和改进，不断改善现有产品质量，以满足市场对产品越来越高的品质需求，确保公司产品的市场适应性，提高产品竞争力。



## 2、积极提升产能，促进降本增效

公司将积极协调资源，并通过持续通过新建产能、工艺优化、技术改造等方式，提升生产规模，确保工厂能够配合销售订单及时制定生产计划、并满足下游客户的多样化需求。同时，公司将积极通过规模化生产、工艺改进、优化生产管理等多举措并行的方式，优化公司产品成本结构，促进降本增效。

## 3、吸引优秀人才，提升管理能力

为了适应未来快速发展的需要，公司积极实施人才战略，建立先进的人才引进、培养和激励机制，不断培养和引进优秀的管理、技术、市场营销、客户服务等方面的人才。公司将建立良好的工作氛围，为员工提供适宜的培训以及富有竞争力的薪酬和福利，建立和实施有效的激励机制，不断激发员工的积极性和创造性。

同时，公司采用先进的管理理念，进一步优化管理架构，提升管理效率，改善管理薄弱点，强化运营职能，凝聚内部发展力量，并借助外部优势资源，全面提升公司的管理水平，推动公司高质量发展。

# 八、财务性投资

## （一）财务性投资及类金融业务的认定标准

中国证监会于 2021 年 6 月发布的《再融资业务若干问题解答》以及深圳证券交易所于 2021 年 6 月发布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》，对财务性投资和类金融业务界定如下：

### 1、财务性投资

“财务性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。

围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。”

## 2、类金融业务

“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。”

此外，根据中国证监会 2021 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》，对上市公司募集资金投资产业基金以及其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应当认定为财务性投资：（1）上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；（2）上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。

### **（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资，下同）情况**

2022年3月7日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。本次董事会前六个月至本募集说明书签署日，公司不存在实施或拟实施财务性投资及类金融业务的情况，具体如下：

#### **1、设立或投资产业基金、并购基金**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在实施或拟实施产业基金、并购基金以及其他类似基金或产品情形。

#### **2、拆借资金**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，除正常业务开展中员工借支款外，公司不存在拆借资金的情形。

#### **3、委托贷款**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在委托贷款的情形。

#### **4、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司未设立集团财务公司。

## 5、购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品。

## 6、非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在投资金融业务的情形。

## 7、类金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司未从事类金融业务。

综上所述，本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务。

### (三) 最近一期末是否存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

截至 2022 年 9 月 30 日，公司可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的相关报表科目情况如下：

单位：万元

序号	科目	截至 2022 年 9 月 30 日账面价值
1	交易性金融资产	-
2	预付款项	494.38
3	其他应收款	35.23
4	其他流动资产	230.70
5	长期股权投资	3,009.05
6	其他非流动资产	200.75

#### 1、交易性金融资产

截至 2022 年 9 月末，公司无交易性金融资产。

#### 2、预付款项

截至 2022 年 9 月末，公司预付款项账面价值为 494.38 万元，主要为向原材料供应商预付的采购款，不属于财务性投资。

### 3、其他应收款

截至 2022 年 9 月末，公司其他应收款账面余额按性质列示如下：

单位：万元

项目	账面余额
押金及保证金	79.63
其他	27.66
合计	107.29

截至 2022 年 9 月末，公司其他应收款主要为与公司经营相关的押金及保证金，不属于财务性投资。

### 4、其他流动资产

截至 2022 年 9 月末，公司其他流动资产金额为 230.70 万元，主要为待抵扣进项税、预缴企业所得税，不属于财务性投资。

### 5、长期股权投资

截至 2022 年 9 月 30 日，公司持有的长期股权投资如下表所示：

单位：万元

序号	企业名称	期末余额	持股比例/份额	主营业务	是否为围绕产业链上下游的产业投资	是否为财务性投资
1	沃凯珑	3,009.05	11.27%	化工产品、化学试剂和助剂研发、生产、制造及销售	是	否

### 6、其他非流动资产

截至 2022 年 9 月末，公司其他非流动资产金额为 200.75 万元，主要为预付设备款，不属于财务性投资。

## 九、报告期内存在未决诉讼、仲裁情况

截至本募集说明书签署日，发行人未决诉讼情况如下：

案号	原告	被告	案由	基本案情	货款金额(元)	进展
(2022)粤1391民初4706号	发行人	惠州联创宏科技有限公司	买卖合同纠纷	因被告拖欠货款，原告起诉请求被告支付货款及利息、承担诉讼费	334,361.50	尚在审理中
(2022)粤	发	广州泰华		因被告拖欠货款，原告	541,305.14	尚在审理

案号	原告	被告	案由	基本案情	货款金额(元)	进展
0114民初13379号	行人	多层电路股份有限公司		起诉请求被告支付货款及利息、承担诉讼费		中
(2022)粤1402民初3395号	发行人	梅州泰华电路板有限公司		因被告拖欠货款,原告起诉请求被告支付货款及利息、承担诉讼费	417,220.00	尚在审理中
(2022)粤0306诉前调35941号	发行人	深圳市聚迅精密电路有限公司		因被告拖欠货款,原告起诉请求被告支付货款及利息、承担诉讼费	124,150.00	诉前沟通调解中
(2022)粤0115民初12029	高仕电研	广州泰华多层电路股份有限公司		因被告拖欠货款,原告起诉请求被告支付货款、承担诉讼费	58,500.00	尚在审理中
(2022)粤0115民初11277号	高仕电研	佛山晶顿电子有限公司、姜辉碧	合同纠纷	因佛山晶顿电子有限公司拖欠货款,姜辉碧对该货款清偿提供连带担保,原告起诉请求佛山晶顿电子有限公司支付货款及滞纳金、承担诉讼费,姜辉碧对上述货款及滞纳金承担连带责任	383,533.45	尚在审理中
货款金额合计					1,859,070.09	

上述未决诉讼中发行人或其子公司均系原告,且金额较小,不属于重大未决诉讼。上述未决诉讼败诉不会对发行人财务状况、盈利能力、持续经营构成重大不利影响。

## 十、报告期内存在行政处罚情况

### (一) 苏州市吴江区市场监督管理局行政处罚

2021年4月23日,苏州市吴江区市场监督管理局向苏州容大下发《行政处罚决定书》(吴江市监处字[2021]164号):苏州容大在厂区内使用未取得相应资格的人员从事特种设备作业,经责令整改逾期仍未改正,违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条的规定,根据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十六条第(二)项的规定,苏州市吴江区市场监督管理局责令苏州容大停止使用相关叉车,并对苏州容大罚款1万元。

根据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十六条第(二)项的规定:“使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的,逾期未改正

的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款”。苏州容大上述行政处罚的罚款金额较小，属于《中华人民共和国特种设备安全法》第八十六条规定的最低罚款金额。

苏州容大及相关人员已按照要求积极主动进行整改，并在已及时缴纳罚款。

综上所述，苏州容大本次违法违规行为的罚款金额较小，不属于在严重损害上市公司利益、投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法违规行为。

## **（二）昆山市交通运输道路综合行政执法大队罚款**

2019年4月，苏州容大因未按照规定参加年度审验，被昆山市交通运输道路综合行政执法大队责令改正并罚款壹仟元整。

根据《江苏省道路运输条例（2017修正）》第六十八条规定：“有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令限期改正，处以一千元以上三千元以下罚款；情节严重的，可以并处吊销相应的道路运输经营许可证件、道路运输证件或者核减相应的经营范围：（一）未按照规定参加年度审验的……”。苏州容大上述行政处罚的罚款金额较小，属于《江苏省道路运输条例（2017修正）》第六十八条规定的最低罚款金额。

苏州容大已按要求足额缴纳罚款且已整改完毕。

除上述情形外，报告期内，发行人不存在其他因违法违规受到行政处罚的情形。

## 第二节 本次证券发行概要

### 一、本次发行的背景和目的

#### (一) 本次发行的背景

##### 1、下游行业发展促进光刻胶市场规模持续增长

光刻胶经过几十年不断的发展和进步，应用领域不断扩大。当前，光刻胶根据应用领域不同，主要可分为 PCB 光刻胶、显示用光刻胶和半导体光刻胶。伴随着下游领域的快速发展，光刻胶市场呈持续增长趋势。

按应用领域分类	主要品种
PCB 光刻胶	干膜光刻胶、湿膜光刻胶、光成像阻焊油墨等
显示用光刻胶	彩色光刻胶及黑色光刻胶、触摸屏用光刻胶、TFT 阵列用光刻胶等
半导体光刻胶	g 线光刻胶、i 线光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 光刻胶、EUV 光刻胶等

在 PCB 领域，近年来，5G 商用化带来了通信系统、网络和终端设备的升级需求，在人工智能、物联网等技术不断完善的背景下，终端设备呈现网络化、智能化趋势。通讯、消费电子、计算机、汽车电子等下游应用领域的蓬勃发展带动 PCB 需求的逐年上升。据 Prismark 公布数据，2016 至 2021 年年全球 PCB 行业市场规模从 533.6 亿美元增长至 809.20 亿美元，年复合增长率为 7.19%；预计 2026 年市场规模将增长至 1,015.59 亿美元，2021 年至 2026 年复合增长率预计达 4.80%。2016 至 2021 年中国（不包含港澳台地区）PCB 行业市场规模从 271 亿美元增长至 442 亿美元，年复合增长率为 8.49%，随着我国 PCB 产值的不断增加，PCB 光刻胶的需求量亦将稳步增长。

在显示领域，随着家用电器、消费电子、汽车电子等行业的发展，以及电视、显示器、智能手机等应用大尺寸化趋势延续，显示行业的市场需求持续增长。根据 Frost & Sullivan 统计，2015 年至 2020 年，按照产量口径，全球显示面板行业市场规模从 1.72 亿平方米增长至 2.42 亿平方米，年均复合增长率为 7.1%。随着显示面板技术的发展和下游需求的增长，预计 2024 年全球显示面板市场规模将达到 2.74 亿平方米。

在半导体领域，随着 5G、汽车电子、人工智能、工业物联网等新兴产业的发展，需求迅猛增长。据 WSTS 统计，2016 至 2020 年全球半导体销售额由

3,348.3 亿美元增长至 4,355.6 亿美元，年复合增长率约为 4.8%。近年来随着数据基础设施、IoT、智慧城市建设和需求旺盛，数据存储需求上涨，半导体需求激增，预计 2020 至 2022 年全球半导体市场规模将由 4,355.6 亿美元增长至 6,060 亿美元，年复合增长率约为 11.6%。

## 2、下游产业链产能转移助推光刻胶国产化率上升

21 世纪以来，全球 PCB、显示面板、集成电路产能逐渐向亚洲尤其是中国转移。在 PCB 行业，根据 PrismaMark 统计，2008 年至 2020 年，中国（不包含港澳台地区）PCB 产值全球占比从 31.1% 提升至 53.8%，预计 2025 年产值占比仍将维持在 50% 以上，已成为全球主要 PCB 制造基地；在显示面板行业，根据 DSCC 预测，中国（不包含港澳台地区）面板产能份额将从 2020 年 53% 提升至 2025 年 71%；在集成电路行业，根据 SEMI 预测，2020-2025 年中国（不包含港澳台地区）地区晶圆产能占全球比例将从 18% 提高至 22%，年均复合增长率约为 7%。相关行业产能向国内转移带动上下游产业链国内需求的快速增长，行业呈明显的进口替代趋势。

在此趋势下，光刻胶产品中部分中低端产品已实现进口替代。根据方正证券数据，PCB 光刻胶中的湿膜及阻焊油墨产品国产化程度相对较高，国产化率达 50%。但由于 PCB 领域的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶技术壁垒较高，并且我国产业链起步较晚，目前国产化率较低。根据方正证券数据统计，各类光刻胶主要品种国产化率情况如下：

按照应用领域分类	主要品种	国产化率
PCB 光刻胶	干膜光刻胶	此前几乎全进口
	湿膜及阻焊油墨	50%
显示用光刻胶	彩色光刻胶	5%
	黑色光刻胶	5%
	TFT-LCD 光刻胶	大部分进口
半导体光刻胶	g 线光刻胶	20%
	i 线光刻胶	20%
	KrF 光刻胶	小于 5%
	ArF 光刻胶	小于 1%
	EUV 光刻胶	研发阶段



注：数据来源为方正证券研究所；其中干膜光刻胶此前几乎全进口，目前福斯特、五江高科等国内企业逐渐投产

在中美科技竞争的大背景下，随着相关产业向中国持续转移和国内配套产业链的完善，未来进口替代仍是趋势所向，公司等部分国内领先企业已在中高端光刻胶产品进口替代上有所突破，光刻胶国产化率有望进一步提升。

### 3、产业链自主可控意义重大，行业迎持续性政策红利

光刻胶是光刻工艺中的关键材料，当前被广泛应用于半导体、显示、PCB等领域，并最终广泛应用于消费电子、通讯、汽车、航空航天、军事装备等关乎国民经济、工业发展的关键行业，产业链自主可控的需求迫切。在此背景下，以光刻胶为代表的电子材料的发展已提升到国家战略高度，我国密集出台一系列政策，大力支持行业的发展，鼓励国产化替代，促进产业链自主可控。与光刻胶相关产业政策如下：

发布时间	发布单位	政策名称	核心内容
2021.03	发改委、工信部等五部门	《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	光刻胶生产企业入围“清单”，可享受税收优惠政策。
2020.12	财政部、税务总局等	《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》	国家鼓励的集成的路线宽小于28纳米(含)，且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税；国家鼓励的集成的路线宽小于65纳米(含)，且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税；国家鼓励的集成的路线宽小于130纳米(含)，且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
2020.11	十三届全国人大四次会议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。
2020.09	发改委等四部门	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长	围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应

发布时间	发布单位	政策名称	核心内容
		极的指导意见》	链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。
2020.07	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率或减半征收企业所得税。
2019.12	工信部	《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019 版)》	推荐材料:集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂、ArF 光刻胶用脂环族环氧树脂、LCD 用正性光刻胶和 gi 线正性光刻胶用酚醛树脂。
2017.12	发改委	《新材料关键技术产业化实施方案》	要发展高端专用化学品，包括 KrF（248nm）光刻胶和 ArF 光刻胶（193nm），为大型和超大型集成电路提供设备，且单套装置规模达到 10 吨/年。
2017.05	发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》	将光刻胶列入“电子核心产业”的“集成电路”项。
2017.04	科技部	《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》	重点研发 300 毫米硅片、深紫外光刻胶等关键材料产品。
2014.06	国务院	《国家集成电路产业发展推进纲要》	开发光刻胶、大尺寸硅片等关键材料，加强集成电路制造企业和装备、材料企业的协作，加快产业化进程，增强产业配套能力。

## （二）本次发行的目的

### 1、顺应行业趋势，优化产品结构，积极扩张产能

随着 5G、智能驾驶、人工智能、物联网等下游创新应用的逐步成熟，PCB、显示、半导体等光刻胶的主要应用领域蓬勃发展，带动光刻胶市场需求快速增长。公司在感光电子化学品行业深耕多年，具备深厚的技术实力和丰富的行业经验积累。公司本次募集资金投资项目中，光刻胶及其配套化学品新建项目是响应国家电子产业链自主可控的迫切需求，结合公司在感光化学品行业多年的技术积累，为满足下游客户日益提升的产品需求，推出的重点项目。

在光刻胶行业国产化替代的大背景下，通过本次募投项目的实施，公司将新增部分光刻胶细分产品及产能，有利于优化公司产品结构，充分匹配客户需求，增强公司的市场竞争力。

## 2、提高盈利能力，优化资产负债结构，促进可持续发展

通过本次发行和募投项目的实施，公司将新增感光干膜、显示用光刻胶和半导体光刻胶产能，有利于公司培育新的盈利增长点。同时，随着公司业务规模的不断扩张，仅依靠自有资金及债务融资已较难满足公司战略目标，本次发行的募集资金将为公司业务发展提供资金支持，有利于公司核心业务的增长和公司战略的实施。本次发行将缓解公司的资金压力，优化资产负债结构，降低公司资产负债率水平，提高盈利能力，促进公司可持续发展。

## 3、满足公司业务发展的流动资金需求，增强公司抗风险能力

在国产化替代的行业趋势下，国内光刻胶市场持续增长。同时，光刻胶行业的技术壁垒较高，下游产业对产品性能要求也不断提升，为把握市场发展机遇、保持技术领先、巩固行业地位，公司在业务规模扩张、技术研发投入、产品结构优化等方面，均需要大量的流动资金投资。同时随着公司业务规模的扩大，采购、生产、研发以及市场开拓等多个营运环节的资金需求迅速增长。本次向特定对象发行股票部分募集资金将用于补充流动资金，有利于缓解公司业务扩张和研发投入带来的运营资金压力，满足流动资金需求，同时增强公司抗风险能力。

## 二、发行对象及与发行人的关系

本次发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

截至本募集说明书签署日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定

发行对象与公司的关系。具体发行对象及其与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

### **三、本次向特定对象发行股票方案概要**

#### **（一）发行股票的种类和面值**

本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

#### **（二）发行方式和发行时间**

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

#### **（三）发行对象及认购方式**

本次发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

#### **（四）发行价格及定价原则**

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$  为调整前发行价格， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送红股或转增股本数， $P1$  为调整后发行价格。

本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和深交所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

### **（五）发行数量**

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过6,403.64万股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。

### **（六）限售期**

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所

的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

### （七）上市地点

本次发行的股票在限售期届满后，将在深交所创业板上市交易。

### （八）滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

### （九）本次发行决议有效期

本次发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

## 四、募集资金投向

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 67,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	光刻胶及其配套化学品新建项目	54,804.19	47,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合 计		<b>74,804.19</b>	<b>67,000.00</b>

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

## 五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，公司本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购本次发行的股票而构成关联交易，将在发行结束后的相关文件中予以披露。

## 六、本次发行不会导致公司控制权发生变化

截至本募集说明书签署日，林海望、杨遇春、黄勇和刘启升四人持有公司合计 102,150,549 股，占比 47.86%，为公司共同实际控制人。

本次发行的股票数量不超过 6,403.64 万股（含本数），若按本次发行数量的上限（即 6,403.64 万股）测算，本次发行完成后，林海望、杨遇春、黄勇和刘启升持有公司股份的比例为 36.81%，仍为公司共同实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

## 七、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件

本次向特定对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。

## 八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2022 年 7 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2、本次向特定对象发行股票尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

在获得中国证监会同意注册的批复后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票呈报批准程序。

## 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### 一、本次募集资金投资项目概述

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 67,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	光刻胶及其配套化学品新建项目	54,804.19	47,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		74,804.19	67,000.00

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

### 二、本次募集资金投资项目可行性分析

#### （一）光刻胶及其配套化学品新建项目

##### 1、项目基本情况

本项目计划投资 54,804.19 万元，建设地点位于珠海市南水镇平湾四路东北侧，实施主体为公司全资子公司珠海容大。

本项目主要建设内容包括：年产 1.20 亿平方米感光干膜光刻胶项目，年产 1.53 万吨显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品，建设单体包括研发楼、车间、仓库、储罐等。项目建成投产后，公司将新增感光干膜、显示用光刻胶和半导体光刻胶产能，其中显示用光刻胶主要以 TFT 阵列用光刻胶为主，半导体光刻胶主要以 g/i 线光刻胶为主。本次募投项目实施有利于公司实现产品结构的优化，提高公司产能规模，持续提升市场竞争力，满足客户需求，巩固行业领先地位。



## 2、项目实施的必要性

### (1) 打造完整自主生产能力，把握感光干膜发展机遇

随着下游 PCB 行业的蓬勃发展，全球感光干膜市场规模持续增长。根据上市公司福斯特（5603806.SH）2021 年公开披露的信息，当前感光干膜市场空间在百亿人民币级别，假设 2021 年感光干膜市场空间为人民币 100 亿元，按照 Prisma 所预计的 2021-2026 年 PCB 行业产值增速为 4.8% 进行推断，则 2025 年感光干膜新增市场空间约为人民币 20.63 亿元。若感光干膜产品的自主替代比重实现突破，则国内具备产品、技术等竞争优势的感光干膜厂商将面临相对更大的新增市场空间。

公司自成立以来深耕感光电子化学品业务，坚持内生式增长和外延式发展并重的发展战略，在夯实主营业务的基础上，密切跟踪产业链发展趋势及机遇。感光干膜作为 PCB 光刻工艺中的关键材料，公司自 2018 年起即组建研发团队负责该领域的技术攻关；2021 年 9 月，公司通过投资正奇新材拓展感光干膜业务，布局感光干膜业务的步伐加快。

感光干膜的生产工艺流程包括聚合、调液、涂布生产、分切包装等环节，生产场地、生产设备、环保设施等固定资产投资规模较大。在发展初期，公司为控制项目投资风险，部分环节采用外协加工的模式，产能受到限制。为把握感光干膜发展机遇，积极拓展大客户，实现规模化发展，公司亟需建立自主规模化生产能力和品质控制能力。

通过本次募投项目的实施，公司将具备 1.20 亿平方米感光干膜的自主生产能力，一方面有利于提升公司对产品生产排期、质量管理等方面的能力，大幅提高重要客户开拓及订单供应保障能力；另一方面有利于公司降低外协加工成本，提高盈利能力，进而有利于公司把握感光干膜发展机遇。

### (2) 顺应进口替代的行业趋势，提升公司规模优势

在国家政策支持、下游市场发展、持续研发投入等因素的综合影响下，我国光刻胶行业市场规模增长迅速。在 PCB、显示面板和集成电路产业国产化进程加速、产业链自主可控需求迫切的背景下，作为上游关键材料的光刻胶呈现明显的进口替代趋势，国产光刻胶或将迎来快速发展的机遇。

截至本募集说明书签署日，公司具备 1,050 吨显示用光刻胶、半导体光刻胶

及配套化学品的生产能力，生产线主要用于触摸屏用光刻胶、半导体用 g/i 线光刻胶等产品的小批量生产。但受限于产能规模，公司难以进入下游核心企业的供应体系，导致当前公司光刻胶业务发展较为缓慢。

通过本次募投项目的实施，公司将新增 1.53 万吨显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品产能，将进一步加强公司的规模优势，匹配客户日益增长的需求，大幅提升市场开拓能力。

### (3) 优化产品结构，拓展新的盈利增长点

随着下游应用领域的不断扩增，光刻胶行业呈现出不断细分的发展趋势，其部分品种和应用领域示意如下：

按照应用领域分类	主要品种	主要应用领域
PCB 光刻胶	干膜光刻胶	微细图形加工
	湿膜及阻焊油墨	微细图形加工
显示用光刻胶	黑色、彩色光刻胶	用于制备彩色滤光片
	触摸屏用光刻胶	用于在玻璃基板上沉积 ITO 制作
	TFT-LCD 正性光刻胶	微细图形加工
半导体光刻胶	g 线光刻胶	6 寸晶圆
	i 线光刻胶	6 寸、8 寸晶圆
	KrF 光刻胶	8 寸晶圆
	ArF 光刻胶	12 寸晶圆
	EUV 光刻胶	12 寸晶圆

数据来源：方正证券研究所

公司自成立以来深耕感光电子化学品行业，始终致力于光刻胶及配套产品研发、生产和销售。通过本次募投项目的实施，公司的产品矩阵将得以进一步优化和丰富，有利于公司充分利用在感光化学品行业的技术积累，为公司扩展新的盈利增长点，推动公司业务规模持续发展。

## 3、项目实施的可行性

(1) 进口替代的行业趋势和持续政策红利，为募投项目的实施创造良好的市场条件

21 世纪以来，全球 PCB、显示、半导体产能逐渐向亚洲尤其是中国转移，

带动上游产业链国内需求的快速增长，行业呈明显的进口替代趋势。并且光刻胶作为关键电子材料，是国家战略新兴产业，最终广泛应用于消费电子、**通讯**、汽车、航空航天、军事装备等行业。在产业链自主可控的战略目标下，近年来，我国陆续出台多项政策促进行业发展。2020年9月，发改委、科技部、工信部、财政部等四部委联合印发《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，指出需加快新材料产业强弱项，加快在光刻胶等领域实现突破。公司迎来持续的政策红利。进口替代的行业趋势和持续政策红利，为本次募投项目实施创造了良好市场条件。

公司等部分国内领先企业在光刻胶中高端产品研发已有一定的突破，光刻胶国产化率有望进一步提升。本次募投项目实施具备广阔的市场空间和良好的外部政策环境。

## **(2) 优质的客户资源与完备的营销体系，为募投项目新增产能的消化奠定了基础**

公司自设立以来，一直深耕感光电子化学品行业，凭借深厚的研发积累、优异的产品性能以及突出的规模优势，公司积累了优质的客户资源，并打造了完备的营销体系。

在 PCB 领域，公司与深南电路股份有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司、胜宏科技（惠州）股份有限公司、崇达技术股份有限公司等业内领先的厂商建立了长期、稳定的合作关系。本次募投项目涉及的产品之一为感光干膜，主要应用于 PCB 领域，与公司现有客户群体基本一致。截至本募集说明书签署日，公司的感光干膜业务已实现销售收入，产品性能获得客户的高度认可。

在显示用光刻胶及半导体光刻胶产品方面，公司 2019 至 2021 年销售额由 2,107.59 万元增长至 2,997.57 万元，年复合增长率达 19.26%，保持较快发展速度。凭借多年的行业积累及完备的营销体系，公司在感光电子化学品领域具备优质的品牌效应，客户开拓卓有成效。公司已与深圳莱宝高科技股份有限公司、扬州扬杰电子科技股份有限公司、三安光电股份有限公司等下游重点企业建立长期、稳定合作关系。

## **(3) 充足的技术和人才储备，为募投项目的实施提供保障**

公司自成立以来，始终专注于感光电子化学品的研发、生产和销售，始终重视技术研发和人才积累，在技术和人才储备方面竞争优势明显。

### ①技术储备

经过多年的研发创新及产业化实践，公司构建了以树脂合成技术、配方设计技术和工艺控制技术为核心的关键技术平台。对于感光干膜产品，公司自2018年开始即组建研发团队负责该领域的技术攻关，2021年9月引入正奇新材后公司加快布局感光干膜业务。依托公司的关键技术平台，截至本募集说明书签署日，公司已自研感光干膜产品的配方及生产技术。

对于显示用光刻胶产品和半导体光刻胶产品，公司始终密切跟踪市场需求，持续维持高强度的研发投入，已陆续完成 g/i 线光刻胶、触摸屏 sensor 制作用高分辨率正性光刻胶及配套显影助剂等产品的量产，并已持续实现销售收入。目前，公司已完成 TFT 阵列用光刻胶产品的研发工作，并已向重点客户送样测试。

截至本募集说明书签署日，公司及子公司拥有发明专利 **43** 项。

### ②人才储备

在人才储备方面，公司核心研发团队具备丰富的感光电子化学品行业从业经验，拥有多名核心技术骨干，研发人员稳定性较强。公司实际控制人之一、董事、副总经理杨遇春先生是全国感光材料标准化技术委员会委员、深圳市地方级领军人才，从事感光电子化学品的研发及产业化工作多年，主持多项广东省科学技术厅、深圳市科技创新委员会等科研项目，作为发明人并已获授权发明专利 29 项、实用新型专利 1 项。公司副总经理晏凯先生从事光刻胶研发及产业化工作多年，主持或参与多项科技部、国家广东省科学技术厅、深圳市科技创新委员会等科研项目，作为发明人并已获授权发明专利 3 项。

公司高度重视感光电子化学品的研发团队的建设，研发团队人数持续增长，截至**2022年9月30日**，公司共有研发人员**99**人，占员工总数的**19.30%**。

公司已建立完善的研究体系。研发活动由技术开发委员会管理，以市场需求为导向，以开发新产品、提高产品性能、稳定生产工艺为目标，结合公司经营发展方针积极制定技术开发方向；各研发项目由技术总监领导，并由项目经

理负责实施。

公司在感光干膜、显示用光刻胶和半导体光刻胶的研发和生产环节已积累了丰富的技术和人才，能够保障本次募投项目的实施。

#### **(4) 丰富的项目建设和生产管理经验，为募投项目的实施和产线运营提供支撑**

公司深耕感光电子化学品行业多年，形成了一套完整的生产管理体系和质量管理体系，积累了生产排期、人员管理、工艺控制、设备维护等方面的丰富经验。近年来，随着公司业务的发展，公司在惠州市大亚湾石化区新建厂房。公司管理团队在产能建设和生产管理中积累了丰富的项目建设和生产运营经验，有助于充分保障本项目的有序建设及稳定运营。

#### **4、项目投资概算**

本项目总投资 54,804.19 万元，其中建设投资(不含预备费)47,961.17 万元，预备费 2,398.06 万元，铺底流动资金 4,444.95 万元，具体投资安排如下：

序号	投资构成	金额	占比
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>50,359.23</b>	<b>91.89%</b>
1.1	土地购置费用	1,976.72	3.61%
1.2	建筑工程费用	22,000.85	40.14%
1.3	配套工程费用	1,054.00	1.92%
1.4	设备购置费用	21,617.40	39.44%
1.5	软件购置费用	1,312.20	2.39%
1.6	预备费	2,398.06	4.38%
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>4,444.95</b>	<b>8.11%</b>
<b>合计</b>		<b>54,804.19</b>	<b>100.00%</b>

注：基本预备费和铺底流动资金由公司自有资金或通过其他融资方式解决，不涉及本次募集资金。

本项目中，公司拟使用募集资金投入 47,000.00 万元，全部为资本性投入。基本预备费和铺底流动资金不使用募集资金，项目剩余部分所需资金将由公司自有或自筹资金予以补足。

本项目投资额的具体测算过程如下：

### **(1) 土地购置费用**

本项目拟在珠海市南水镇平湾四路东北侧购置土地建设项目。根据珠海市公共资源交易中心公告，本项目拟购置土地占地面积 82.36 亩，即 54,909 平方米，土地购置单价为 360.00 元/平方米，土地购置费用约 1,976.72 万元。

### **(2) 建设工程费用**

建设工程费主要包括生产厂房及配套工程的土建和装修费用，以及工程建设其他费用，其中土建和装修费用主要根据本项目规划情况、类似工程的建设指标，并结合所在地区最新价格水平进行估算；工程建设其他费用主要根据本项目投资规模、建设规划，并结合公司以往项目情况和现时市场情况进行估算。公司建设工程费估算金额为 22,000.85 万元。

### **(3) 配套工程费用**

配套工程费用主要包括设计费、地质勘探费、工程建设监理费、安评费、环评及能评费、绿化工程、消防工程等，本项目配套工程费用约 1,054.00 万元。

### **(4) 设备购置费用**

设备购置及安装费主要根据项目建设的产能规模、工艺流程及技术要求，拟定各个生产环节所需的设备清单，设备价格依据公司设备采购计划、类似设备采购价格、供应商报价进行测算。公司设备购置及安装费估算金额为 21,617.40 万元。

### **(4) 软件购置费用**

本项目软件价格依据公司软件采购计划、类似软件采购价格、供应商报价进行测算，预计软件购置费用为 1,312.20 万元。

### **(5) 预备费**

项目预备费是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要预留的费用，按工程建设费（包括土地购置费用、建筑工程费用、配套工程费用、设备购置费用、软件购置费用）的一定比例进行估算，基本预备费估算金额为 2,398.06 万元。

## （6）铺底流动资金

铺底流动资金是项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金。本项目流动资金需求估算按照募投项目投产后流动资产和流动负债各项构成分别详细估算。根据公司和本项目的情况，本项目铺底流动资金估算金额为 4,444.95 万元。

## 5、项目建设期

本项目将建设启动时间节点设为 T，预计整体建设期为 2 年。本项目建设期主要包括环评/能评/安评、厂房设计、报建、土建施工、设备订购、水电安装及消防、厂房验收、场地装修及设备安装调试、试运行等内容。具体如下所示：

序号	实施步骤	T+1 年				T+2 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	环评/能评/安评								
2	厂房设计								
3	报建								
4	土建施工								
5	设备订购								
6	水电安装及消防								
7	厂房验收								
8	场地装修及设备安装调试								
9	试运行								

## 6、项目经济效益分析

经测算，本项目满产后，预计年均营业收入为 142,593.64 万元，年均税后利润为 14,047.53 万元；本项目税后内部收益率为 16.66%，所得税后静态投资回收期为 7.66 年，项目预期效益良好。

### （1）测算假设

本次募投项目效益测算假设：1）公司所处的国内及国际宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态；2）公司各项业务所遵循的法律、法规、行业政策、税收政策无重大不利变化；3）募投项目主要经营所在地及业务涉及地区的社会、经济环境无重大变化；4）行业未来发展趋势及市场情况无重大变

化，行业技术路线不发生重大变动；5) 在项目计算期内上游原材料供应商不会发生剧烈变动，下游用户需求变化趋势遵循市场预测；6) 人力成本价格不存在重大变化；7) 公司能够继续保持现有管理层、核心技术团队人员的稳定性和连续性；8) 募投项目未来能够按预期及时达产；9) 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

## (2) 测算过程

### 1) 收入测算

公司预计在项目建设期第3年开始投产，在第5年可实现满负荷生产，前4年的达产比例依序为0%、0%、60%、80%，之后按100%的产能利用率计算。

本次募投产品感光干膜、显示用及半导体用光刻胶尚无公开市场价格。截至本募集说明书签署日，感光干膜产品公司已实现小批量销售，因此项目投产后感光干膜产品售价主要参考历史售价进行测算；显示用光刻胶产品以新产品TFT阵列用光刻胶为主，公司尚未实现销售收入，因此项目投产后价格主要参考客户报价情况及同行业可比公司披露情况进行测算，价格逐年下降1%；半导体光刻胶产品以g/i线光刻胶为主，公司已实现销售，因此项目投产后半导体光刻胶产品售价主要参考历史售价进行测算，价格逐年下降1%。

### 2) 成本测算

由于公司产品直接材料种类繁多，为简化处理，直接材料成本公司根据类似产品历史耗用情况进行预计。

人工成本根据需要使用的人员数量、公司项目所在地同类岗位员工历史工资水平进行测算，并基于谨慎性原则，员工的工资水平按照每年3%的增速递增。

固定资产折旧、无形资产摊销综合考虑公司现有折旧摊销政策进行谨慎估算。

燃料动力成本主要结合产品生产工艺及类似产品历史耗用占收入的比例进行预计。

### 3) 费用测算



期间费用率参考历史期费用占收入的平均比例进行测算。

#### 4) 税费测算

各项税费以当地政府现行税率及公司历史经验数值为基础，合理考虑未来情况进行测算。

具体测算结果如下表所示：

单位：万元

序号	项目构成	T+1年	T+2年	T+3年	T+4年	T+5年	T+6年	T+7年	T+8年	T+9年	T+10年
1	主营业务收入	0.00	0.00	88,103.78	116,701.08	144,922.70	143,978.58	143,043.91	142,118.58	141,202.50	140,295.59
2	减：主营业务成本	0.00	189.01	60,796.03	80,318.60	99,808.24	99,959.71	99,998.04	100,037.86	100,079.21	100,122.13
3	减：税金及附加	0.00	0.00	12.01	634.86	778.69	763.97	749.38	734.95	720.66	706.51
4	减：销售费用	0.00	0.00	6,167.26	8,169.08	10,144.59	10,078.50	10,013.07	9,948.30	9,884.18	9,820.69
5	减：管理费用	39.53	39.53	4,405.19	5,835.05	7,246.13	7,198.93	7,152.20	7,105.93	7,060.13	7,014.78
6	减：研发费用	0.00	0.00	2,643.11	3,501.03	4,347.68	4,319.36	4,291.32	4,263.56	4,236.08	4,208.87
7	减：财务费用	0.00	0.00	1,013.56	1,411.78	1,800.21	1,770.78	1,743.94	1,717.32	1,690.93	1,664.76
8	利润总额	-39.53	-228.54	13,066.62	16,830.68	20,797.15	19,887.34	19,095.96	18,310.66	17,531.33	16,757.85
9	减：所得税（25%）	0.00	0.00	3,199.63	4,207.67	5,199.29	4,971.83	4,773.99	4,577.66	4,382.83	4,189.46
10	净利润	-39.53	-228.54	9,866.98	12,623.01	15,597.86	14,915.50	14,321.97	13,732.99	13,148.50	12,568.38
11	净利率			11.20%	10.82%	10.76%	10.36%	10.01%	9.66%	9.31%	8.96%
12	毛利率			30.99%	31.18%	31.13%	30.57%	30.09%	29.61%	29.12%	28.63%
12.1	感光干膜			23.20%	24.72%	25.57%	25.49%	25.44%	25.40%	25.35%	25.31%
12.2	光刻胶			35.04%	34.56%	34.08%	33.30%	32.61%	31.91%	31.20%	30.49%
12.2.1	显用示光刻胶			34.02%	33.53%	33.04%	32.24%	31.54%	30.83%	30.11%	29.38%
12.2.2	半导体光刻胶			38.40%	37.94%	37.49%	36.74%	36.09%	35.42%	34.75%	34.07%
12.2.3	光刻胶配套化学品			26.06%	26.20%	26.36%	26.22%	26.17%	26.13%	26.08%	26.04%

### (3) 测算结果合理性分析

#### 1) 与公司现有业务的对比分析

公司本次募投项目平均毛利率水平与公司现有业务的对比情况如下：

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
公司报告期内显示用及半导体光刻胶业务毛利率	50.11%	45.74%	56.91%	59.91%
本次募投项目显示用及半导体光刻胶业务毛利率	30.49%-35.04%			

由上表可见，公司本次募投项目显示用及半导体光刻胶毛利率水平低于报告期内同类业务毛利率水平，测算较为谨慎。

#### 2) 与同行业可比公司同类业务的对比分析

##### a. 感光干膜

公司的感光干膜产品主要竞争对手为福斯特，福斯特未披露感光干膜业务毛利率，因此选用福斯特历次募集资金投资项目披露的效益测算对比如下：

公司名称	来源	(子)项目名称	毛利率(%)
福斯特	2021年可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明	年产4.2亿平方米感光干膜项目[注1]	23.72
		1亿平方米感光干膜项目	25.86
	2018年可转换公司债券	年产2.16亿平方米感光干膜项目	26.00
容大感光	2022年向特定对象发行股票	年产1.20亿平方米感光干膜项目	25.31-25.57

注1：福斯特“年产4.2亿平方米感光干膜项目”项目经济效益指标包括配套项目“年产6.145万吨碱溶性树脂项目”中约2.7万吨产能。

公司本次募投项目中感光干膜毛利率略低于福斯特，毛利率测算总体较为谨慎。

##### b. 显示用、半导体用光刻胶及配套化学品

由于显示用、半导体用光刻胶领域同行业可比上市公司通常未披露光刻胶板块毛利率情况，因此选用同行业可比公司历次募集资金投资项目披露的效益测算对比如下：

公司名称	来源	(子)项目名称	毛利率
南大光电	2020年向特定对	光刻胶项目	54.78%

公司名称	来源	(子)项目名称	毛利率
	象发行股票		
上海新阳	2020年向特定对象发行股票	集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目	56.74%
雅克科技	2020年非公开发行	新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂	17.57%
晶瑞电材	2018年可转换公司债券	新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目	25.59%
<b>均值</b>			<b>38.67%</b>
容大感光	2022年向特定对象发行股票	年产1.53万吨显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品	<b>30.49%-34.08%</b>

公司的光刻胶及其配套化学品项目毛利率低于同行业上市公司可比募投项目平均值，具有合理性。

## 7、项目报批事项及土地情况

本项目拟建设地点位于珠海市南水镇平湾四路东北侧，截至本募集说明书签署日，公司已取得本次募投项目土地不动产权证书，证书编号为粤（2022）珠海市不动产权第0066174号。

本项目已在广东省投资项目在线审批监管平台完成备案登记，备案项目代码为2201-440404-04-01-676290。

截至本募集说明书签署日，本次募投项目已取得珠海市发展和改革委员会出具的《珠海市发展和改革委员会关于光刻胶及其配套化学品新建项目节能报告的审查意见》（珠发改节能[2022]24号），已办理完成能评手续。

截至本募集说明书签署日，本次募投项目已取得珠海市生态环境局出具的《珠海市生态环境局关于珠海市容大感光科技有限公司光刻胶及其配套化学品新建项目环境影响报告书的批复》（珠环建书[2022]40号），已办理完成环评手续。

## 8、募投项目的资金使用安排

本项目建设期为24个月，计划总投资为54,804.19万元，拟使用募集资金47,000.00万元。在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。后续公司再根据项目进度逐步投入募集资金，在项目建设期内将募集资金

使用完毕。

公司本次向特定对象发行股票方案已经由 2022 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。本次募集资金不包含相关董事会决议日前已投入资金，亦不存在使用募集资金置换本次董事会前投入资金的情形。

## **（二）补充流动资金**

### **1、项目基本情况**

本次向特定对象发行股票，公司拟使用募集资金 20,000.00 万元用于补充流动资金，以满足未来业务发展的资金需求，提升持续盈利能力，优化资本结构，降低财务费用，提高抗风险能力。

### **2、项目实施的必要性和可行性**

#### **（1）满足未来业务发展的资金需求，助力公司业务扩张**

公司自成立以来，一直致力于感光电子化学品的研发、生产和销售，产品主要应用于 PCB、显示、半导体等领域，并最终广泛应用于消费电子、**通讯**、汽车、航空航天、军事装备等行业。随着市场需求的持续增长以及公司经营规模的持续扩大，公司在业务规模扩张、技术研发投入、产品结构升级优化等方面，均需要大量的流动资金投资；同时公司在采购、生产、研发以及市场拓展等多个营运环节中资金需求迅速增加，流动资金需求较高。因此，本次公司拟使用募集资金 20,000.00 万元补充流动资金，为未来经营发展提供资金保障，助力公司业务扩张。

#### **（2）为研发战略实施提供资金保障，提高公司的市场竞争力**

光刻胶行业的技术壁垒较高，并且下游产业对产品性能要求不断提升，为持续保持公司的市场竞争力，未来公司将持续投入研究开发新产品、新技术，提高产品性能，扩充产品矩阵。本次补充流动资金有利于公司在技术研发、工艺创新、产品开发等方面持续投入，满足经营规模快速扩张带来的资金需求，从而为公司战略实施提供资金保障，提高公司的市场竞争力。

#### **（3）进一步优化资本结构，增强抗风险能力**

近年来，随着经营规模的不断扩张，公司资金需求持续增长，同时也导致

公司资产负债率不断提高。截至**2022年9月末**，公司资产负债率为**34.35%**。通过本次发行补充流动资金，有利于进一步降低资产负债率、优化资本结构，有利于公司增强抗风险能力和提高可持续发展能力。本次补充流动资金综合考虑了公司业务发展情况、现金流状况、资本结构以及预期运营资金缺口等因素，整体规模适当，具备合理性。

### **3、本次发行补充流动资金的规模是否符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》**

除了补充流动资金外，本次发行募集资金均用于募投项目中的资本性支出，公司本次募投项目光刻胶及其配套化学品新建项目的预备费和铺底流动资金均由公司以自有资金或通过其他融资方式解决，不涉及本次募集资金。公司本次发行补充流动资金金额为 20,000.00 万元，占募集资金总额的比例不超过 30.00%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的要求。

## **三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系**

公司的主营业务为 PCB 光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等感光电子化学品的研发、生产和销售，主要产品为 PCB 感光油墨、PCB 感光干膜、特种油墨、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等系列感光电子化学品。公司本次发行募集资金围绕主营业务展开，其中光刻胶及其配套化学品新建项目是公司顺应产业发展趋势、响应下游客户需求、优化公司产品结构做出的重要布局，符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于进一步提升公司盈利能力，增强公司市场竞争力，促进公司可持续发展。补充流动资金可以为公司未来业务发展提供资金保障，优化公司资本结构，降低财务风险。

## 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

### 一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况

#### （一）本次发行对公司业务与资产的影响

公司的主营业务为 PCB 光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等感光电子化学品的研发、生产和销售，主要产品为湿膜光刻胶、阻焊油墨、干膜光刻胶、特种油墨、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等系列电子感光化学品。公司本次发行募集资金围绕主营业务展开，通过本次募投项目的实施，公司将具备 1.20 亿平方米感光干膜的自主生产能力并新增 1.53 万吨显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品产能，将进一步加强公司的规模优势，匹配客户日益增长的需求，公司的产品矩阵将得以进一步优化和丰富，有利于公司充分利用在感光化学品行业的技术积累，为公司扩展新的盈利增长点，推动公司业务规模持续发展。补充流动资金项目将有利于公司进一步降低资产负债率、优化资本结构，有利于公司增强抗风险能力和提高可持续发展能力。

本次发行完成后，公司的主营业务范围不会产生重大变化，公司亦暂无业务及资产整合计划。

#### （二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司注册资本、股本总额及股本结构将发生变化，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》相关条款进行修改，并办理工商变更登记。

#### （三）本次发行对公司股东结构的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。本次发行不会导致公司控股股东与实际控制人发生变化。

#### （四）本次发行对高管人员结构的影响

截至本募集说明书签署日，公司尚无调整高级管理人员的计划，本次发行亦不会对高级管理人员结构造成重大影响。本次发行完成后，若公司拟调整高

级管理人员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

### **（五）本次发行对业务结构的影响**

本次募集资金投资项目系公司对主营业务的进一步拓展与强化，项目实施后将增强公司主营业务的收入规模与盈利能力，但不会导致公司业务收入结构发生重大变化。

## **二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况**

### **（一）本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模均相应增加，营运资金更加充裕，资产负债结构更为合理。本次发行有利于优化公司资本结构，改善财务状况，增强偿债能力，降低财务风险，为公司业务扩张和健康发展奠定坚实基础。

### **（二）本次发行对公司盈利能力的影响**

本次发行是公司顺应产业发展、响应客户需求、巩固行业领先地位的重要战略布局。由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需一定时间，净利润短期内难以与净资产保持同步增长，因此短期内公司每股收益和净资产收益率将相应出现一定程度的下降。但从长远来看，随着募集资金投资项目的投产和效益的实现，公司盈利能力和市场竞争力将不断增强，本次发行将对公司未来的财务指标产生积极影响。

### **（三）本次发行对公司现金流量的影响**

本次发行完成后，募集资金到位将使得公司筹资活动产生的现金流入金额大幅增加；在募集资金具体投入项目后，投资活动产生的现金流出金额也将大幅增加；随着募投项目的实施和效益产生，公司盈利能力不断增强，经营活动产生的现金流入金额将逐步增加。

## **三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况**

公司经营管理体系完善、人员机构配置完整，具有完全自主的独立经营能



力。本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务、管理关系和同业竞争状况不会发生重大变化。本次发行也不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增同业竞争或关联交易。

#### **四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形**

截至本募集说明书签署日，公司不存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，也不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

本次发行完成后，公司亦不存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，也不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

#### **五、本次发行对公司负债情况的影响**

截至 2022 年 9 月末，公司资产负债率为**34.35%**。本次发行完成后，公司资产负债率将有所下降，有利于进一步优化资产负债结构，降低财务风险，公司整体抗风险能力和持续经营能力进一步增强。公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。

## 第五节 前次募集资金的使用情况

### 一、前次募集资金的基本情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

##### 1、2020年发行股票、可转换公司债券购买资产

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向牛国春等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3240号）核准，同意深圳市容大感光科技股份有限公司向牛国春发行 467,077 股股份、向袁毅发行 180,804 股股份、向李慧发行 67,801 股股份、向石立会发行 37,667 股股份、向牛国春发行 773,760 张可转换公司债券、向袁毅发行 299,520 张可转换公司债券、向李慧发行 112,320 张可转换公司债券、向石立会发行 62,400 张可转换公司债券购买广东高仕电研科技有限公司（以下简称“高仕电研”）100%股权的注册申请。

本次购买高仕电 100% 股权（以下简称“标的资产”）的交易总价为 20,800.00 万元；其中以发行股份支付 2,080.00 万元，共计发行 753,349.00 股股份，发行价格为 27.61 元/股；其中以发行可转换债券支付 12,480.00 万元，共计发行 1,248,000.00 张可转换公司债券，票面金额为 100 元/张；其中以现金支付 6,240.00 万元，交易具体对价情况如下：

金额单位：万元

序号	交易对方	转让的股权出资额	转让的股权出资比例	交易总额	发行股份支付金额	发行可转换公司债券支付金额	现金支付金额
1	牛国春	1,240.00	62.00%	12,896.00	1,289.60	7,737.60	3,868.80
2	袁毅	480.00	24.00%	4,992.00	499.20	2,995.20	1,497.60
3	李慧	180.00	9.00%	1,872.00	187.20	1,123.20	561.60
4	石立会	100.00	5.00%	1,040.00	104.00	624.00	312.00
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,800.00</b>	<b>2,080.00</b>	<b>12,480.00</b>	<b>6,240.00</b>

2020年12月28日，高仕电研取得广州南沙经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更完成后，公司合计持有高仕电研 100.00% 股权。

公司前次发行股份、可转换公司债券购买资产仅涉及以发行股票、可转换公司债券形式购买标的资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间。

### **（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况**

公司前次发行股份、可转换公司债券购买资产仅涉及以发行股票、可转换公司债券形式购买标的资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金在专项账户的存放情况。

### **（三）募集资金的管理情况**

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2022年6月30日，公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

## **二、前次募集资金实际使用情况**

### **（一）前次募集资金使用情况对照表**

#### **1、2020年发行股票、可转换公司债券购买资产**

公司前次发行股份、可转换公司债券购买资产仅涉及以发行股票、可转换公司债券形式购买标的资产，未涉及募集资金的实际流入，前次募集资金使用情况是发行股份、可转换公司债券购买资产及资产的权属变更情况。

截至2022年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额：			14,560.00			已累计使用募集资金总额：			14,560.00	
变更用途的募集资金总额：			不适用			各年度使用募集资金总额：			14,560.00	
						2020 年度：			14,560.00	
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2021 年度：			0.00	
						2022 年 1-6 月：			0.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	发行可转换债券购买高仕电研 100% 股权	发行可转换债券购买高仕电研 100% 股权	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	14,560.00	0.00	2020 年 12 月 28 日
2	发行股份购买高仕电研 100% 股权	发行股份购买高仕电研 100% 股权	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00			

注：募集资金总额是指公司本次购买高仕电研 100% 股权中以发行股份和可转换债券支付的对价部分。

## **（二）前次募集资金实际投资项目变更情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

## **（三）前次募集资金是否已基本使用完毕或募集资金投向未发生变更且按计划投入**

公司前次募集资金投向均未发生变更，2020 年度发行股份、可转换公司债券购买资产累计使用比例为 100%。公司前次募集资金到位至本次发行董事会决议日的时间间隔超过 6 个月，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关规定。

## **（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## **（五）闲置募集资金情况说明**

公司前次发行股份、可转换公司债券购买资产仅涉及以发行股票、可转换公司债券形式购买标的资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在使用暂时闲置的前次募集资金的情况。

# **三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

## **（一）首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况说明**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			最近两年一期实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2020 年度	2021 年度	2022 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月		
1	购买高仕电研 100% 股权	不适用	1,500.00	1,750.00	2,000.00	2,753.41	3,264.65	1,489.07	7,507.13	是

注：2020 至 2021 年度数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-6 月数据未经审计。

## （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益有差异的情况。

## 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

### 1、标的资产权属变更情况

截至 2020 年 12 月 28 日止，高仕电研已完成工商变更登记手续以及股权过户手续，本次变更完成后，公司合计持有高仕电研 100.00% 股权，根据《资产购买协议》及补充协议，结合北京中天华资产评估有限责任公司以 2019 年 12 月 31 日为基准日出具的中天华资评报字[2020]第 10378 号评估报告，本次交易对价为 20,800.00 万元，其中以发行股份支付 2,080.00 万元，公司新增注册资本人民币 753,349.00 元，新增股本人民币 753,349.00 元，余额合计人民币 20,046,651.00 元转入资本公积（股本溢价）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司本次新增注册资本及股本情况，并于 2021 年 1 月 13 日出具“信会师报字[2021]第 ZB10003 号”验资报告。

2021 年 1 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕，公司向本次交易对方发行新股数量为 753,349.00 股，均为有限售条件的流通股，股份的上市日期为 2021 年 1 月 29 日。发行后公司股份数量为 156,753,349.00 股。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，公司定向可转债（证券代码：124019，证券简称：容大定转）已于 2021 年 1 月 26 日完成初始登记，登记数量为 1,248,000.00 张。

牛国春、袁毅、李慧、石立会持有的“容大定转”于 2022 年 2 月 17 日完成转股，转股价格为 22.94 元/股，转股数量为 5,440,276 股，此部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股登记，转股情况如下：

持有人	持有债券总数（张）	申请转股债券数量（张）	转股价格（元/股）	转股数量（股）
牛国春	773,760	773,760	22.94	3,372,972
袁毅	299,520	299,520	22.94	1,305,666
李慧	112,320	112,320	22.94	489,625
石立会	62,400	62,400	22.94	272,013
<b>合计</b>	<b>1,248,000</b>	<b>1,248,000</b>		<b>5,440,276</b>

## 2、标的资产账面价值变化情况

2020年至2022年6月，标的资产账面价值变化情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	12,395.51	13,354.38	9,488.23
负债总额	3,560.45	3,737.82	2,315.68
净资产	8,835.06	9,616.56	7,172.55

注：2020年12月31日、2021年12月31日数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度6月30日数据未经审计。

## 3、生产运营及效益贡献情况

2020年至2022年6月，标的资产盈利情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,489.07	3,264.65	2,753.41

注：2020年度、2021年度数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度1-6月数据未经审计。

## 4、业绩承诺的实现情况

根据《资产购买协议》及补充协议约定，牛国春、袁毅、李慧、石立会承诺高仕电研2020年度、2021年度及2022年度三个会计年度的净利润分别不低于1,500.00万元、1,750.00万元及2,000.00万元。

金额单位：人民币万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度
承诺业绩数	2,000.00	1,750.00	1,500.00
实际完成数	1,489.07	3,264.65	2,753.41



项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度
完成率	74%	187%	184%

注：2020年度、2021年度数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度1-6月数据未经审计。

## 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至2022年6月30日，容大感光前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

## 六、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人前次募集资金使用情况出具了“信会师报字[2022]第 ZB10989 号”《关于深圳市容大感光科技股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》，审核结论如下：

“我们认为，容大感光截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，如实反映了容大感光截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况。”

## 第六节 与本次发行相关的风险因素

### 一、募集资金投资项目风险

#### (一) 募投项目新增产能消化风险

公司本次募集资金主要投向“光刻胶及其配套化学品新建项目”及“补充流动资金项目”。本次募投项目投产后，公司将具备 1.20 亿平方米感光干膜自有产能，较公司 2022 年 1-9 月感光干膜年化销量扩大约 37.85 倍；在报告期内公司的显示用及半导体用光刻胶产能利用率较低背景下，显示用及半导体用光刻胶将新增每年 1.53 万吨产能，产能扩大约 14.57 倍。对于感光干膜产品，根据福斯特及五江高科披露的已建产能及扩产计划，在公司本次募投项目投产后，国内感光干膜的产能规模预计约占 2025 年国内市场空间的比重为 73.78%；对于显示用及半导体用光刻胶，根据雅克科技、彤程新材、晶瑞电材、广信材料等主要企业披露的产能及扩产计划估算，在公司本次募投项目投产后，国内产能规模预计占 2025 年国内市场空间的比重为 40.01%。

如遇到市场开拓不及预期、宏观经济或下游 PCB、显示面板、半导体行业或消费电子、通讯、汽车、航空航天、军事装备等最终应用领域需求发生不利变化或若行业产能扩张超出预期甚至导致出现产能规模大于市场需求的情形、市场竞争加剧或管理不善等情形出现，将会导致本次募集资金投资项目新增产能存在无法按预期及时消化的风险。

公司在论证募投项目产能消化时，重点考虑并测算了公司现有主要客户及正在进行验证测试的新客户的需求情况。但一方面公司能否通过主要客户的验证测试存在不确定性；另一方面，主要客户均为相关行业内领先企业，其光刻胶产品供应商通常维持在两家或以上，客户根据产线需求分配订单，如果公司不能成为该等客户的首选供应商则可能无法取得充足订单，从而光刻胶项目存在产能消化风险。

#### (二) 募投项目效益不及预期的风险

本次发行相关的募投项目均围绕公司主营业务开展，光刻胶及其配套化学品新建项目税后内部收益率为 16.66%，项目预计效益水平是在综合考虑了公司

现有业务盈利水平、同行业类似项目或类似业务盈利水平、预计市场空间、市场竞争程度等因素基础上做出的审慎预测。

但募投项目的实施和效益产生均需一定时间，因此从项目实施、完工、达产以至最终的产品销售等均存在不确定性。若在募投项目实施过程中，宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化，产品技术路线发生重大更替，下游需求增长缓慢，公司产品验证进展不顺或市场开拓成效不佳，所处行业竞争加剧，公司产品销售价格持续下降以及其他不可预计的因素出现，都可能对公司募投项目的顺利实施、业务增长和预期效益造成不利影响。**特别的，若行业产能扩张超出预期甚至大于市场需求量，可能导致感光干膜行业竞争加剧，进而可能导致公司募投项目产能消化不及预期及市场价格下降至募投项目测算价格以下，募投项目存在效益不及预期的风险。若项目达产后的产品实际单位售价较预测价格下降超过 14.43%且单位产品成本不变时，项目会产生亏损；若项目达产后的产品实际单位成本较预测上涨超过 20.84%且单位售价不变时，项目会产生亏损。**

### **（三）募投项目涉及的技术实施及产品开发风险**

光刻胶及其配套化学品新建项目投产后，公司将新增**感光干膜自主生产能力和显示用光刻胶细分产品**。本次募投项目是公司顺应产业发展、响应客户需求、提升核心竞争力的重要战略布局。公司已对募投项目的可行性进行了充分地分析和论证，并且公司已在新产品、**新产线**的技术基础、生产工艺、**客户验证**和产能消化等方面做了充分准备，**相关产品已通过部分客户测试并已实现销售，预计技术实施风险较小**。如果项目无法顺利研发或投产，或因建成投产后市场环境发生较大不利变化、公司新产品的前期认证和市场开拓进展不畅等因素影响，**又或者产品通过客户验证后仍无法取得足量订单**，将对公司募投项目的实施及新产品的开拓产生一定的不利影响。

### **（四）新增折旧、摊销费用导致的利润下滑风险**

本次募投项目建成后，每年将会产生一定的固定资产、无形资产折旧摊销费用，其中建设期 2 年的折旧摊销费分别为 39.53 万元和 297.81 万元，占 2021 年净利润的 0.99%和 7.44%，投产期第一年的折旧摊销费为 3,312.58 万元，占

当年预计净利润的 **23.88%**。尽管公司对募投项目进行了充分论证和可行性分析，但上述募投项目收益受宏观经济、产业政策、市场环境、竞争情况、技术进步等多方面因素影响，若未来募投项目的效益实现情况不达预期，募投项目新增的折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响。

## 二、宏观经济波动风险

公司自成立以来，一直致力于感光电子化学品的研发、生产和销售，产品主要应用于 PCB、显示、半导体等领域，并最终广泛应用于消费电子、**通讯**、汽车、航空航天、军事装备等行业。相关行业的景气程度与国内和全球宏观经济发展状况密切相关。若未来经济景气度持续低迷甚至下滑、国际间贸易回升缓慢，进而可能导致下游应用领域的发展缓慢，并最终对公司的生产经营和盈利空间造成不利影响。

## 三、市场竞争加剧的风险

近年来，随着国内其他感光电子化学品企业的快速发展，以及具有技术、资金、渠道等多方面优势的行业内外资企业在我国生产基地的陆续建成，行业竞争日趋激烈。如果公司不能在技术、品牌、产品性能及成本等方面继续保持竞争优势，日益激烈的市场竞争会对公司的市场份额、盈利水平产生不利影响。

## 四、财务风险

### （一）业绩及毛利率下滑的风险

报告期内，公司营业收入分别为 45,511.22 万元、54,396.17 万元、78,577.37 万元及 **54,126.91 万元**，归属于上市公司股东的净利润分别为 3,783.71 万元、5,683.05 万元、4,000.20 万元及 **3,338.44 万元**。最近一年及一期公司业绩有所下降，主要原因是：（1）公司于 2020 年 12 月实施股权激励发生大额股份支付费用；（2）公司的主要客户分布在受疫情影响较大的华南和华东地区，受此影响，公最近一期销售数量有所下降；（3）2021 年以来各地政府陆续出台完善能源消费强度和总量双控方案，导致公司上游供应商的产能受限，公司主要原材料树脂、溶剂、单体等价格出现不同程度的上涨，公司产品的销售价格调整有限，无法有效降低或消化上游原材料价格上升带来的不利影响，从而影响公司

产品毛利率水平，进而影响公司盈利能力。

报告期内，公司综合毛利率分别是 32.10%、30.30%、27.82%、**27.40%**，整体呈现下滑的趋势。公司报告期毛利率下滑主要系主要产品的原材料成本上涨，同时下游市场竞争激烈，公司难以将原材料价格的上涨完全传递至下游市场所致。

若未来市场需求发生不利波动、市场竞争加剧，或者原材料价格大幅上升，又或者公司未能加强成本控制，持续提升技术创新能力并保持一定领先优势，公司可能面临未来经营业绩及毛利率下滑的风险。

## （二）原材料价格波动的风险

报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比重分别约为 93.47%、88.75%、90.53%、**90.72%**，占比相对较高，原材料的价格变化将影响公司生产的稳定性和盈利能力。公司主要原材料为树脂、单体、助剂等，若未来宏观经济波动或市场供需不平衡等因素导致原材料价格大幅上升，或者主要原材料供应出现短缺等情形，公司未能及时有效应对，将会对经营业绩造成不利影响。

## （三）应收账款金额较大的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 19,631.87 万元、28,684.60 万元、33,341.28 万元和 **28,260.51 万元**，占资产总额的比重分别为 27.69%、28.34%、28.39%和 **24.31%**，应收账款金额较大，虽然公司应收账款整体处于合理水平，**对逾期且较长时间未收回的应收账款及时、全额计提了坏账准备**，应收账款周转正常，但若公司主要应收账款客户经营状况发生不利变化，导致款项不能及时收回或发生坏账，将会对公司的资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

## （四）商誉减值风险

报告期各期末，公司商誉金额分别为 0 万元、12,811.76 万元、13,235.98 万元和 **13,235.98 万元**，占公司总资产的比例为 0%、12.67%、11.27%和 **11.39%**，主要系报告期内收购高仕电研、正奇新材形成。根据《企业会计准则》的要求，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。若未来相应公司不能实现预期收益，则该等商誉将存在减值风险。

## 五、经营风险

### （一）管理风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司经营规模将进一步扩张，对公司战略规划实施、资源整合、市场开拓、人员管理、销售管理、财务管理等方面提出了更大的挑战与更高的要求。如果公司不能持续有效地提升经营管理能力，导致组织建设和管理体系不能完全适应业务规模的扩张，将会削弱公司的市场竞争力，并对公司经营成果和盈利状况造成不利影响。

### （二）自有房产未取得权属证书的风险

截至本募集说明书签署日，公司及子公司正在使用的自有房屋中，未办理产权证书的面积合计约 27,680.18 平方米，主要系位于惠州科技的部分房产。该处房产系公司主要生产基地和经营场所，系公司核心经营资产，占自有房产面积 57.82%，该生产基地生产的相关产品产量占公司合并口径总产量的 88.40%。

截至本募集说明书签署日，惠州科技已经取得惠州大亚湾经济技术开发区住房和城乡建设局出具的《建设工程竣工联合验收意见书》（惠湾建联验字[2022]第 0066 号），并已完成竣工验收备案，正在申请办理相关房屋所有权登记手续。该等房屋建筑物产权证办理完毕的时间存在不确定性，如发行人未能及时办妥权属证书或因该等事项受到有关部门处以责令改正并处罚款的行政处罚，虽然实际控制人作出了承担相关损失的承诺，但仍可能对公司未来生产经营产生一定的不利影响。

### （三）租赁房产未取得权属证书的风险

截至本募集说明书签署日，公司之子公司高仕电研、正奇新材租赁的房产因历史原因尚未取得权属证书，存在被认定为违章建筑及被责令拆除、或相应的租赁合同存在被认定无效的可能性，公司存在无法继续使用该等房屋的风险，从而对公司短期内的业务经营产生不利影响。

### （四）未决诉讼风险

截至本募集说明书签署日，公司存在作为原告且金额较小的未决诉讼，公司已对上述未决诉讼涉及的应收账款全额计提了坏账准备。如果未决诉讼败诉

公司仍将面临相关贷款无法收回的风险。

#### **（五）行政处罚风险**

报告期内，公司存在两起行政处罚，金额合计为 11,000 元，公司已足额缴纳罚款并完成整改。公司经营规模的扩张对公司管理水平提出了更高的要求，未来存在因管理不善等原因被相关主管部门行政处罚的风险。

### **六、股价波动的风险**

公司股票的二级市场价格受多种因素影响而上下波动，除了公司经营业绩、财务状况及所处行业发展前景等基本面因素之外，国家财政政策及货币政策、国际资本市场环境、市场买卖双方力量对比以及投资者心理预期均可能影响股票价格走势。股票价格具有不确定性，提醒投资者注意相关投资风险。

### **七、本次发行导致原股东分红减少、表决权被摊薄的风险**

本次发行后，公司总股本将会增加，原股东的持股比例将有所下降，由于本次发行完成后，公司的新老股东按持股比例共同分享本次发行前的滚存未分配利润，因此，存在原股东分红减少以及表决权被摊薄的风险。

### **八、审批风险**

本次发行股票方案已经公司董事会和股东大会审议通过，并需获得深圳证券交易所审核以及中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。能否取得相关审核与注册批复，以及最终通过审核与取得注册批复的时间存在不确定性。

### **九、发行风险**

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定对象，且最终根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。本次向特定对象发行股票的发行结果将受到宏观经济和行业发展情况、证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次向特定对象发行股票存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险。

## 十、不可抗力和其他意外因素的风险

不排除因政治、经济、自然灾害、疫情等不可抗力因素或其他意外因素对公司生产经营带来不利影响的可能性。



## 第七节 与本次发行相关的声明

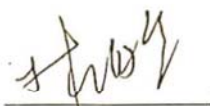
### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

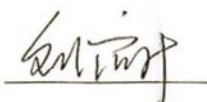
公司全体董事：



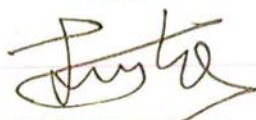
黄勇



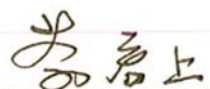
林海望



刘启升



杨遇春



蔡启上



牛国春



曾一龙



张瑾



卢北京



深圳市容大感光科技股份有限公司

2023年 1 月 31 日

## 第七节 与本次发行相关的声明

### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司全体董事：

黄勇

林海望

刘启升

杨遇春

蔡启上

牛国春

曾一龙

张瑾

卢北京

深圳市容大感光科技股份有限公司

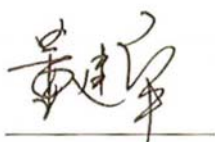
2023年 1 月 31 日

## 第七节 与本次发行相关的声明


### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

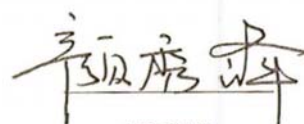
公司全体监事：



董建华



魏志均



颜秀峰

深圳市容大感光科技股份有限公司



2023年 | 月 31 日

## 第七节 与本次发行相关的声明

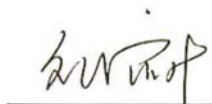
### 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

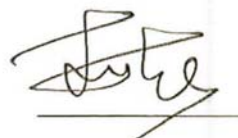
公司全体高级管理人员：



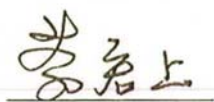
黄勇



刘启升



杨遇春



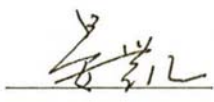
蔡启上



曾大庆



陈武



晏凯



深圳市容大感光科技股份有限公司

2023年1月31日


## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

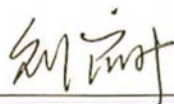
控股股东、实际控制人：



黄勇



林海望



刘启升



杨遇春



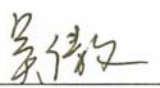
深圳市容大感光科技股份有限公司

2023年1月31日

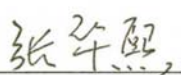
### 三、保荐人及其保荐代表人声明

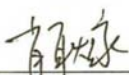
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

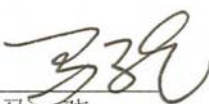
  
吴 傲

保荐代表人：

  
张华熙

  
肖耿豪

总经理：

  
马 骁

董事长、法定代表人（或授权代表）：

  
江 禹

华泰联合证券有限责任公司



2023年1月31日

## 保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读深圳市容大感光科技股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：

  
马 骁

保荐机构董事长（或授权代表）：

  
江 禹

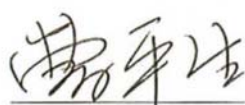
华泰联合证券有限责任公司



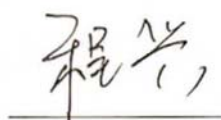
#### 四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《深圳市容大感光科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

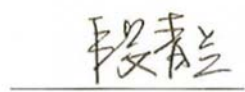
经办律师：



曹平生



程兴

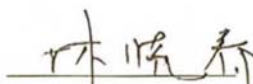


段青兰



蔡腾飞

律师事务所负责人：



林晓春



广东信达律师事务所

2023年1月31日



## 五、会计师事务所声明

本所及经办注册会计师已阅读深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的信会师报字[2021]第 ZB10469 号、信会师报字[2022]第 ZB10658 号审计报告及其他相关报告不存在矛盾。本所及签字会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告及其他相关报告文件的内容无异议，确认募集说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本声明仅供深圳市容大感光科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

经办注册会计师签字：



常明



杨彩凤

会计师事务所负责人签字：

杨志国



本所及经办注册会计师已阅读深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的信会师报字[2020]第 ZB10351 号审计报告及其他相关报告不存在矛盾。本所及签字会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告及其他相关报告文件的内容无异议，确认募集说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本声明仅供深圳市容大感光科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。

经办注册会计师签字：

中国注册会计师  
王志勇  
210700430009

王志勇

隋振涛（已离职）

会计师事务所负责人签字：

杨志国

杨志国

立信  
立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
(公章)  
2023年1月31日

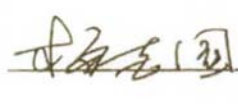

### 关于签字注册会计师离职的说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对深圳市容大感光科技股份有限公司 2019 年度财务报表进行了审计，于 2020 年 4 月 23 日出具了信会师报字[2020]第 ZB10351 号审计报告。

在本函出具日，签署该审计报告的签字注册会计师之一隋振涛（注册会计师证书编号：310000062431）已于本所离职，故无法在深圳市容大感光科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书出具的会计师事务所声明上签字。

本说明函仅供深圳市容大感光科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之目的使用，不得用作任何其他目的。特此说明。

会计师事务所负责人签字：

杨志国



## 六、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项

### （一）关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

根据公司未来发展规划、行业发展趋势，并结合公司的资本结构、融资需求以及资本市场发展情况，除本次向特定对象发行股票外，公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划。若未来公司有其他股权融资计划时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

### （二）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺

根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出了承诺，详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-100）。



深圳市容大感光科技股份有限公司董事会

2023年1月31日